

KEK



実際の現場より： Belle II実験から見る計測

中村克朗 (KEK素核研)

2020年7月31日
総研大講義「計測と制御」

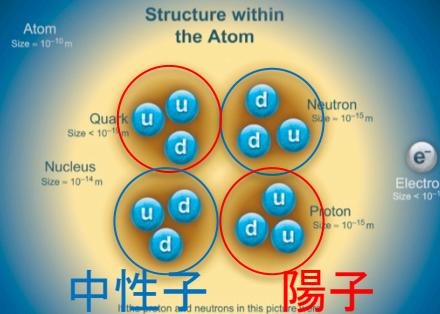
自己紹介



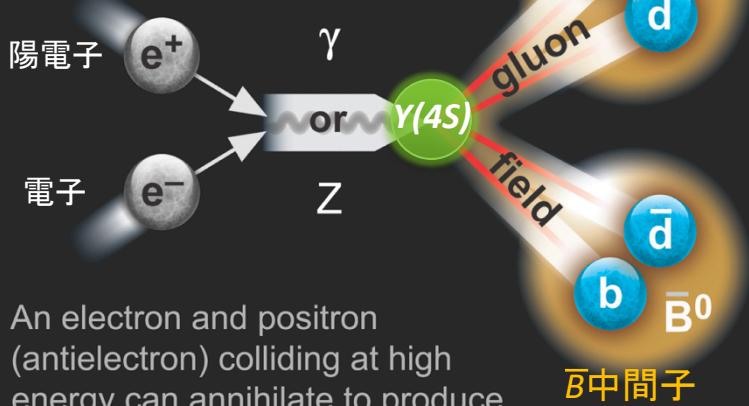
- 中村 克朗 : KEK 素粒子原子核研究所・助教
- 学位取得は京都大学の原子核ハドロン研究室・RHIC PHENIX実験
(偏極陽子衝突実験)
- 現在は、Belle II実験 シリコンストリップ検出器の開発・運転
- 今日はBelle II実験を例に、
大型素粒子実験での粒子計測について話します
- 内容にまとまりがないかもしれませんご容赦ください

物質と素粒子

素粒子で見る原子構造(He原子)



$e^+ e^- \rightarrow B^0 \bar{B}^0$
Belle II 実験



<http://www.cpepphysics.org>

標準理論

物質を形作る粒子

	第1世代	第2世代	第3世代
クォーク	u アップ	c チャーム	t トップ
レブトン	d ダウソ	s ストレンジ	b ボトム
	V_e eニュートリノ	V_μ μ ニュートリノ	V_τ τ ニュートリノ
	e 電子	μ ミュオン	τ タウ

力を伝える粒子

強い力	g グルーオン	
電磁力	γ 光子	
弱い力	W^+ W ホゾン	W^- Z ホゾン



人類が知る素粒子の一覧表

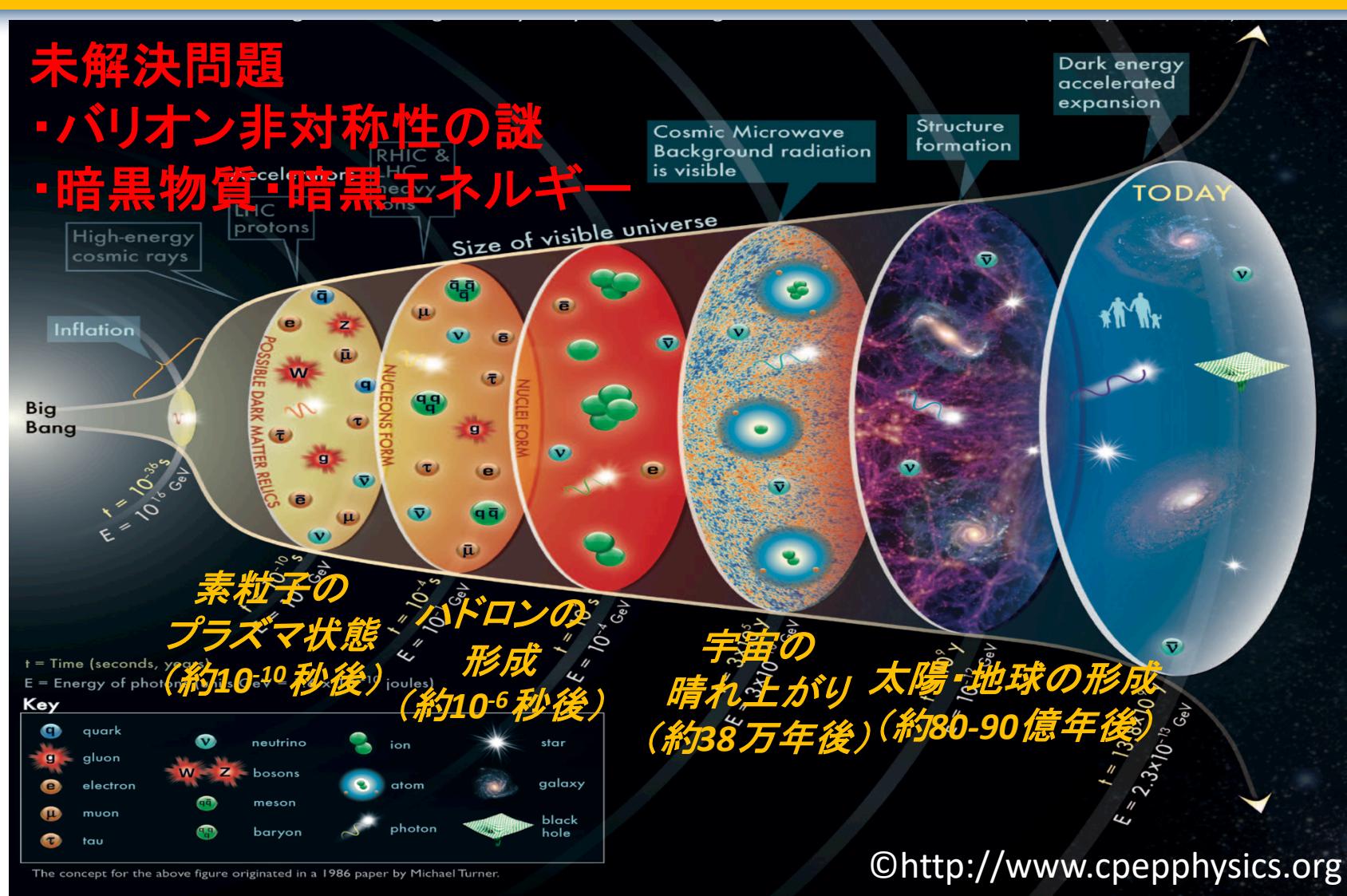
$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ ゲージ対称性
+ ヒッグス機構

ニュートリノ振動・重力相互作用を除く
素粒子実験結果を無矛盾に説明

初期宇宙の発展と素粒子物理

未解決問題

- ・バリオン非対称性の謎
- ・暗黒物質・暗黒エネルギー



宇宙の謎

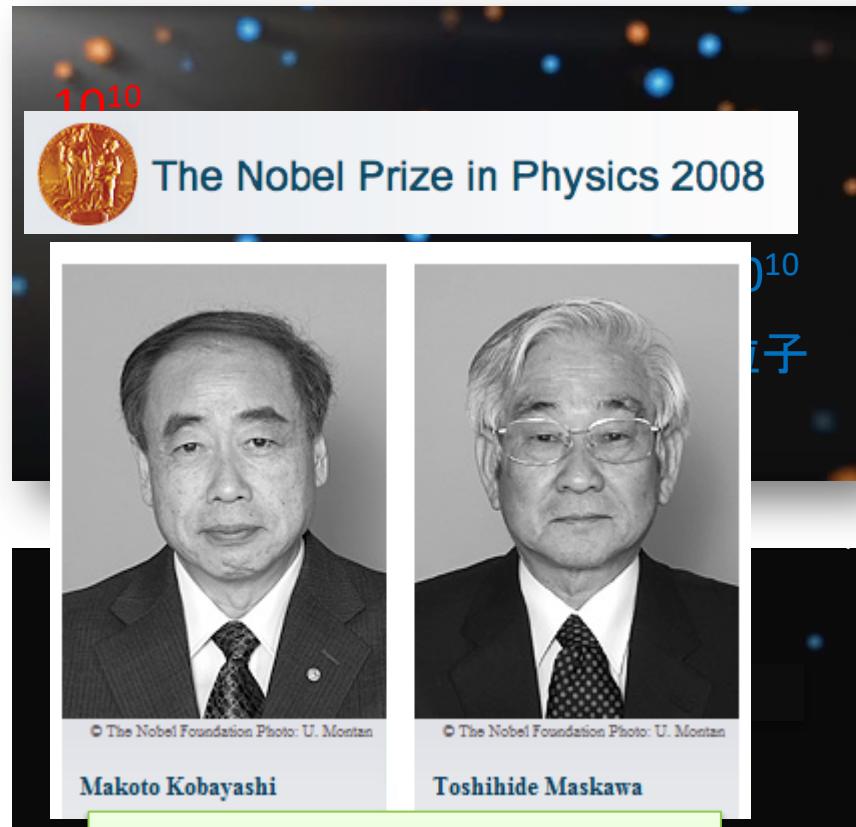
反粒子の消失

物質を形作る粒子 反粒子とは？



$$\begin{pmatrix} 1 - \lambda^2/2 & \lambda & A\lambda^3(\rho - i\eta) \\ -\lambda & 1 - \lambda^2/2 & A\lambda^2 \\ A\lambda^3(1 - \rho - i\eta) & -A\lambda^2 & 1 \end{pmatrix}$$

Belle 実験が理論の証明に貢献



しかしながら、小林益川理論のCP対称性の破れでは
反粒子の消失を説明するには不十分！
さらなるCP対称性の破れ → 標準模型を超える物理
また、バリオン数非保存の新たな相互作用が必要 (← サハロフの3条件)

標準模型の先に踏み込む

- さまざまな新物理模型のアイデア

標準理論

物質を形作る粒子

第1世代		第2世代		第3世代	
クォーク	レブトン	クォーク	レブトン	クォーク	レブトン
u アップ	d ダウ	c チャーム	s ストレンジ	t トップ	b ボトム
eニュートリノ e 電子		V_e eニュートリノ μ ミュオン	V_μ μニュートリノ τ タウ	V_τ τニュートリノ	

力を伝える粒子



拡張



- 超対称性理論 (SUSY)

- Two Higgs-Doublet Model

- 余剰次元模型

- レプトクォーク
Hidden Sector

- $U(1)'$ Z'ボソン
- 暗黒光子
- アクシオン

- など候補は色々…

高エネルギー素粒子実験での粒子計測

- 素粒子実験で現れる粒子は多数
 - Particle Data Group (PDG) 参照 : <https://pdg.lbl.gov/index.html>
 - 粒子は直接見ることはできない

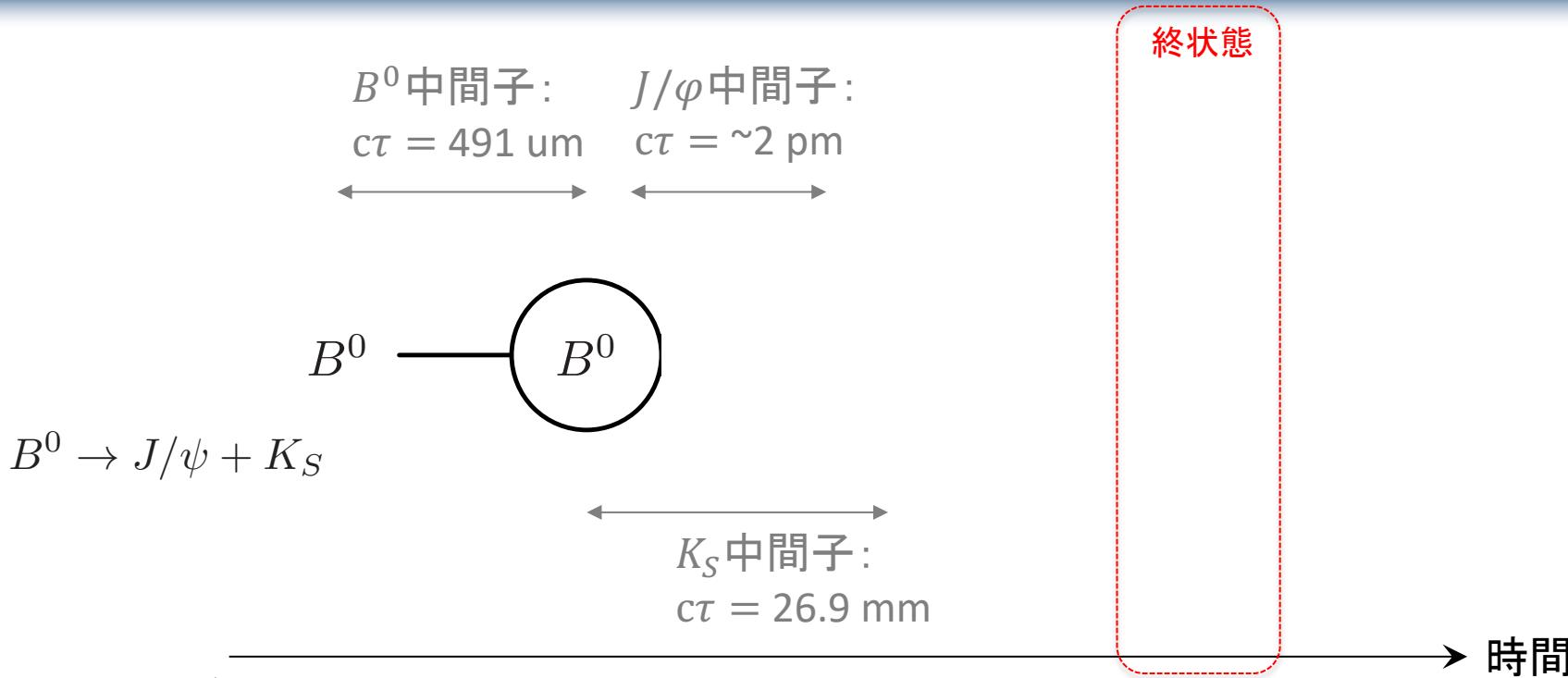
荷電粒子（電荷を持った粒子）： 電磁相互作用してくれる

- 物質を通過する際に様々な形で“痕跡”を残す
 - イオン化、励起、蛍光、チェレンコフ光、等々
- この痕跡を電気信号に変換して読み出すことで粒子を検出し、様々な情報を計測することができる
 - 運動量、速さ、エネルギー、等々 → 検出器

中性粒子（電荷を持たない粒子）：

- 何らかの反応を用いて荷電粒子に変換することで測定
 - 例: γ (光子) は電磁シャワーにより電子・陽電子に変換

終状態における粒子



- 終状態：検出器の大きさのスケールで残った粒子の状態
 - 長寿命粒子のみが残る： $c\tau > 1\text{m}$ 程度
- 現実的には我々が観測するのは終状態の粒子のみ
 - 例外：ストレンジネスハドロン・原子核実験等
- 終状態には限られた種類の粒子のみが現れる

終状態に現れる粒子

- 終状態には限られた種類の粒子のみが現れる

荷電粒子

- π^\pm 中間子、 K^\pm 中間子、 e^\pm 、 μ^\pm 、陽子

$$c\tau = 3.7 \text{ m}$$

$$c\tau = 660 \text{ m}$$

中性粒子

- γ (光子)、 K_L 中間子、中性子、 ν (ニュートリノ)

$$c\tau = 15.3 \text{ m}$$

- 測定したいのは終状態の粒子の4元運動量

終状態の荷電粒子の測定

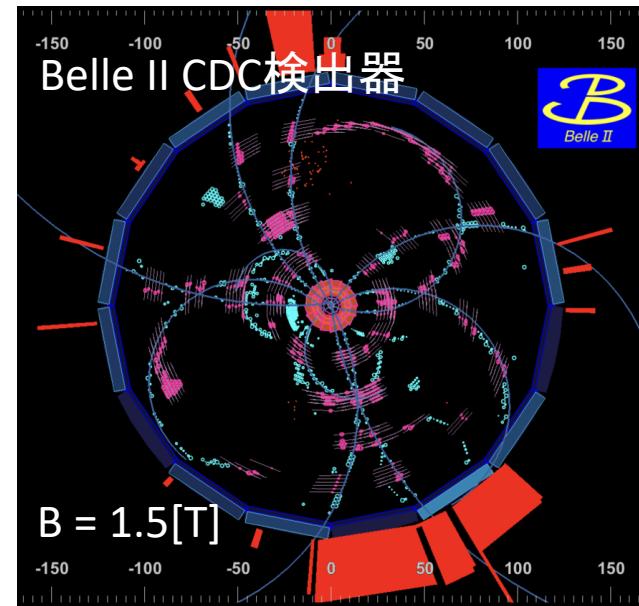
荷電粒子

- π^\pm 中間子、 K^\pm 中間子、 e^\pm 、 μ^\pm 、陽子
- 基本的にエネルギー損失の小さい痕跡を利用して測定
→ 粒子はその後もほぼ同じ運動量で飛び続ける
- さまざまな検出器を組み合わせて、複数の情報を測定可能
 - 例：崩壊点検出器 → 崩壊位置
 - 飛跡検出器 → 運動量
 - 粒子識別検出器 → 粒子種
 - カロリメーター → エネルギー

終状態の荷電粒子：運動量

荷電粒子

- π^\pm 中間子、 K^\pm 中間子、 e^\pm 、 μ^\pm 、陽子
- 荷電粒子は磁場中でローレンツ力によって運動方向を曲げられる
(フレミングの左手の法則)
- 一様な磁場では円運動となる
- $p[\text{GeV}/c] = 0.3 \times \rho[\text{m}] \times B[\text{T}]$
 - 曲率半径と磁場から運動量がもとまる
 - 電荷が同じ限り、この計算式はどの粒子でも同じ
- 逆に、狙う運動量 と 磁場の強さ から検出器のおおまかな大きさが決まる



終状態の荷電粒子：粒子識別

荷電粒子

- π^\pm 中間子、 K^\pm 中間子、 e^\pm 、 μ^\pm 、陽子
- 粒子識別：測定した運動量 + 質量or反応の違いを利用

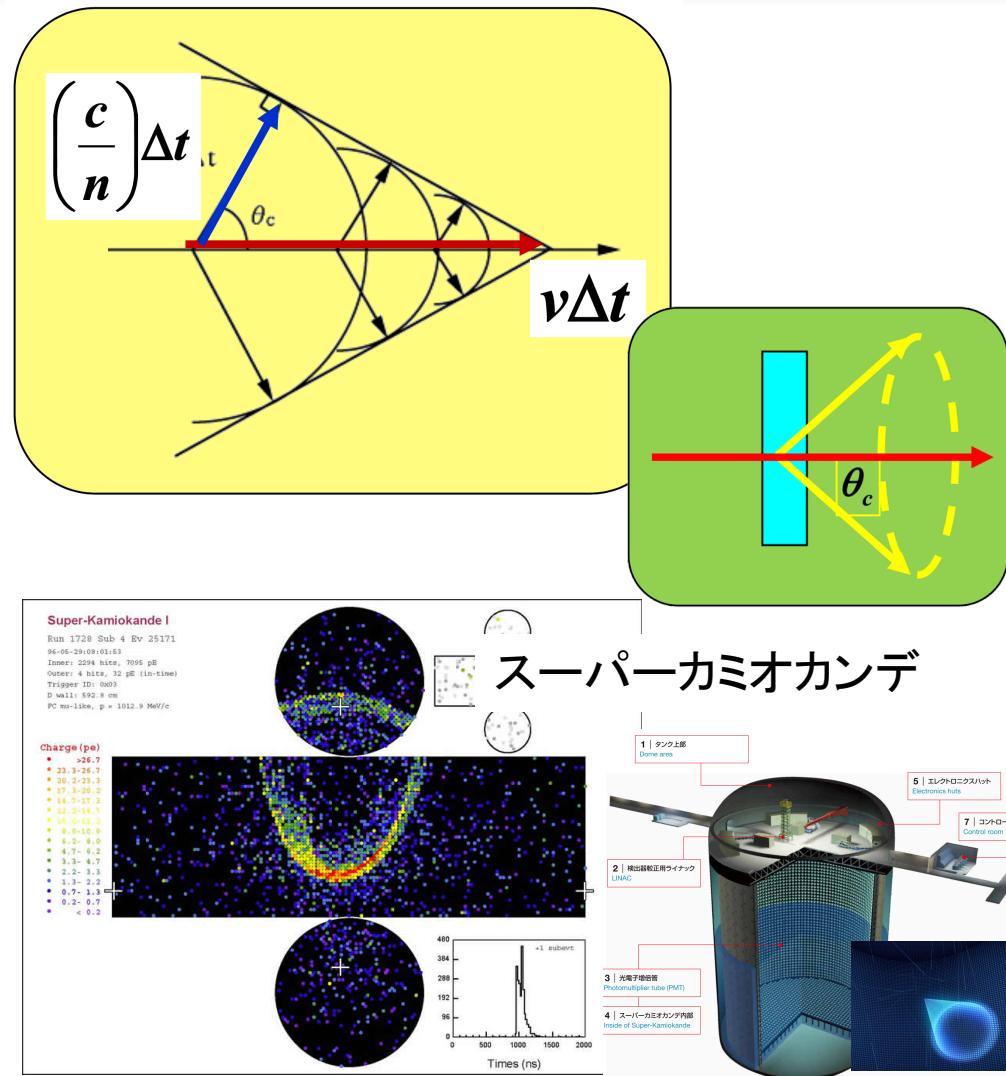
関係式 $p = \gamma\beta m$ を利用

- 方法1. 速度 β or γ を測定
 - TOF(Time of Flight)検出器、チェレンコフ検出器、 dE/dx 測定、Transition Radiation検出器
- 方法2. 反応の違いを利用する
 - 電磁カロリメータによる電子識別(電磁シャワー)
 - カロリメータで大きなエネルギーを落とさない： μ 識別

速度 β の測定手法の例（1）

チエレンコフ光

- 物質中の光の速度は屈折率の分遅くなり c/n
- 粒子の速度が物質中の光の速度を超えることができる
→ 光の衝撃波 = チエレンコフ光
- $\cos \theta_c = (n\beta)^{-1}$
放射角から粒子速度 β が求まる
- 運動量が大きい領域で有効
 - $\beta > 1/n$ が必要
- ただし、運動量が大きすぎて $\beta = 1$ に近づくと識別できなくなる



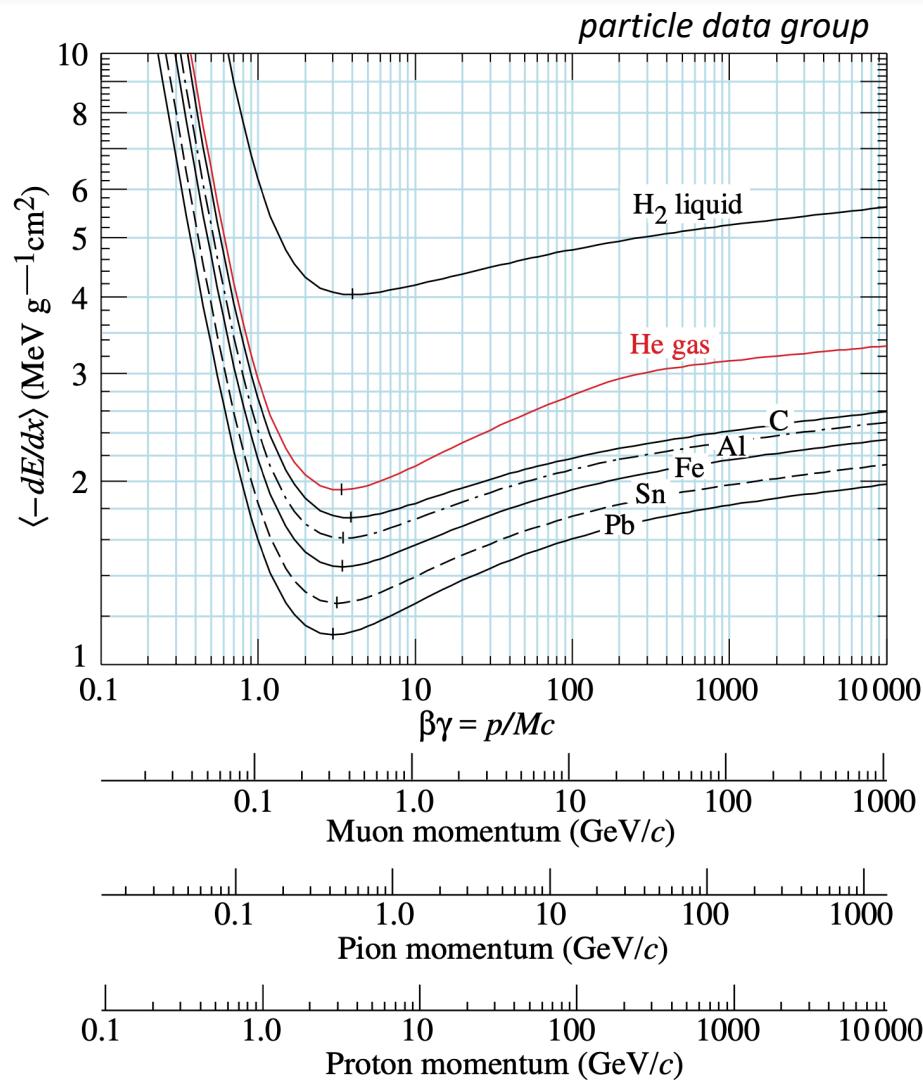
速度 β の測定手法の例（2）

エネルギー損失： dE/dx

- Bethe-Blochの公式

$$\left\langle -\frac{dE}{dx} \right\rangle = K z^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 W_{\max}}{I^2} - \beta^2 - \frac{\delta(\beta\gamma)}{2} \right]$$

- dE/dx は粒子速度 β に依存
→ 粒子種を分けることが可能
- 運動量が小さい領域で特に有効
 - β が小さいと dE/dx の β 依存性がとても大きくなる
- 運動量が大きい領域でも効果はあるが識別精度は限定的

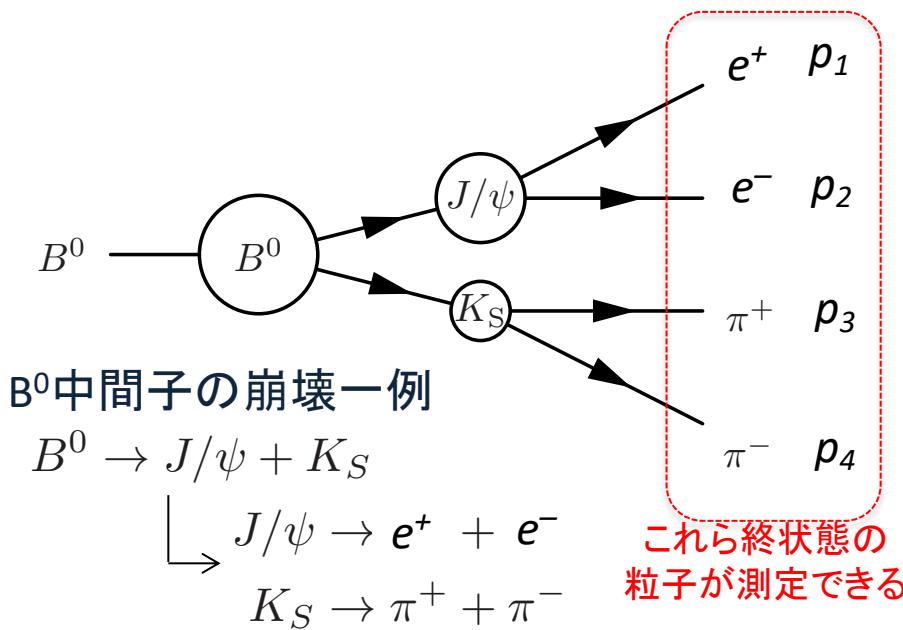


終状態の中性粒子の測定

中性粒子

- γ (光子)、 K_L 中間子、中性子、 ν (ニュートリノ)
- 何らかの反応を用いて荷電粒子に変換することで測定
→ 基本的に反応後は違う粒子となる
- γ (光子) : 電磁カロリメーターで電磁シャワーを起こしてエネルギーを測定
- K_L 中間子 : ハドロンカロリメータでハドロンシャワーを起こしてエネルギーを測定
- ν : 物質中で荷電力レント反応 中性子 + $\nu \rightarrow$ 陽子 + l^- を起こして l^- の情報からエネルギーを測定 (カミオカンデ)
- 粒子識別 : 反応様式から識別可能
- 4元運動量 : 測定したエネルギー + 発生位置 (ビーム衝突点などを仮定) と反応位置から定まる運動量方向

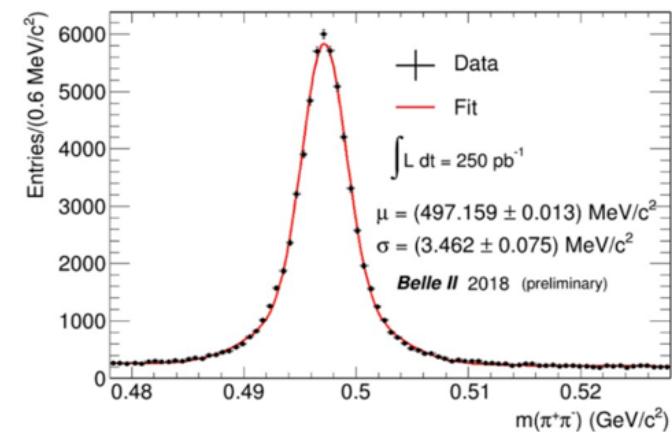
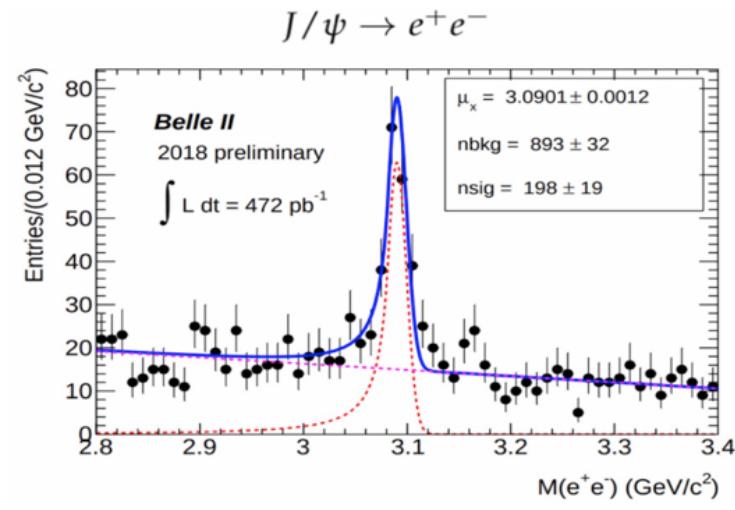
親粒子の再構成



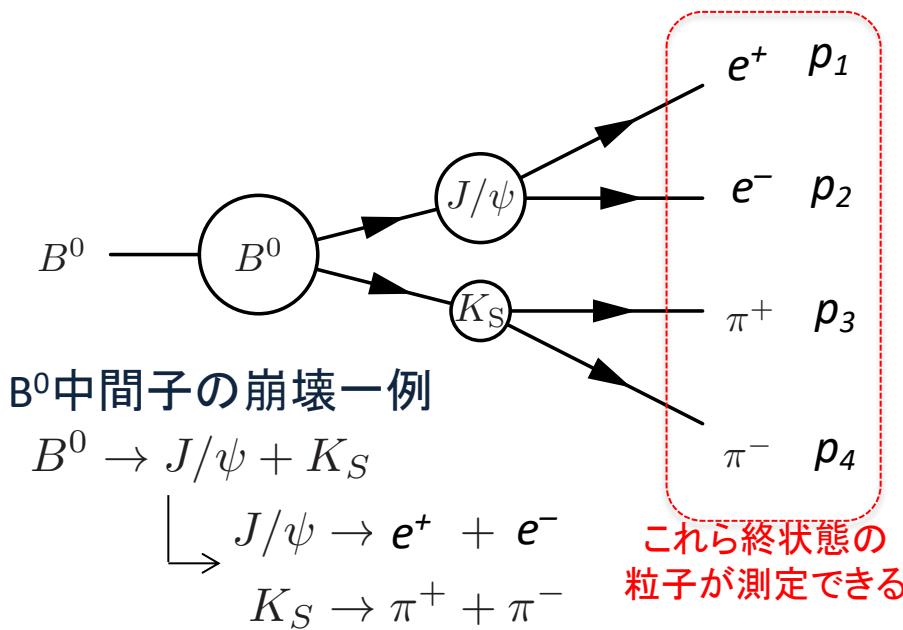
- 「一般的に」崩壊前の親粒子の同定は4元運動量から再構成される質量分布を用いる

- $m(B^0) = 5.280 \text{ GeV}/c^2$
- $m(J/\psi) = 3.097 \text{ GeV}/c^2$
- $m(K_S) = 0.498 \text{ GeV}/c^2$

Step.1: J/ψ , K_S 中間子を再構成



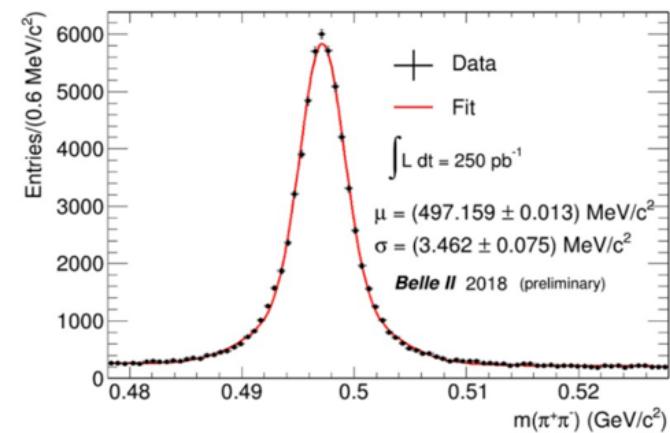
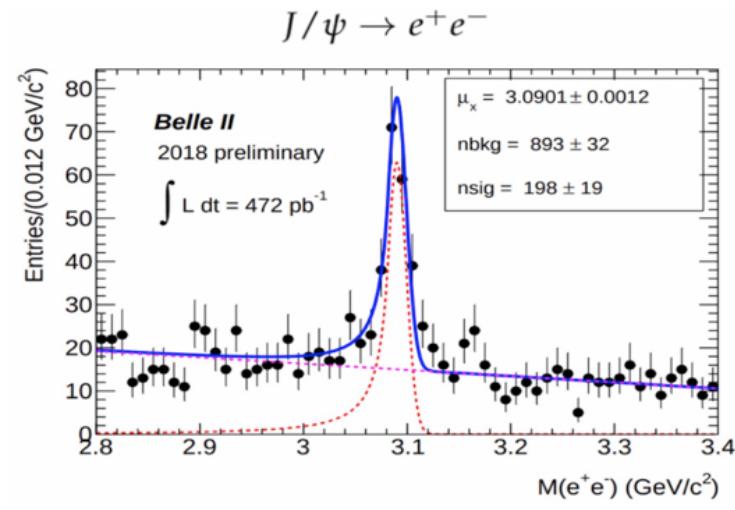
親粒子の再構成



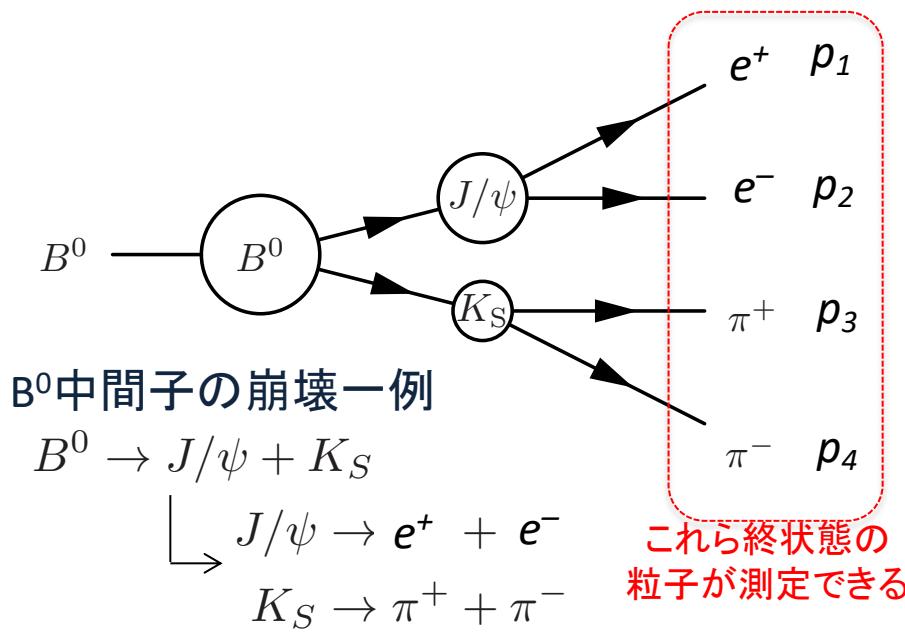
- 「一般的に」崩壊前の親粒子の同定は4元運動量から再構成される質量分布を用いる

- $m(B^0) = 5.280 \text{ GeV}/c^2$
- $m(J/\psi) = 3.097 \text{ GeV}/c^2$
- $m(K_S) = 0.498 \text{ GeV}/c^2$

Step.2: J/ψ , K_S 質量ピーク付近の粒子を選定

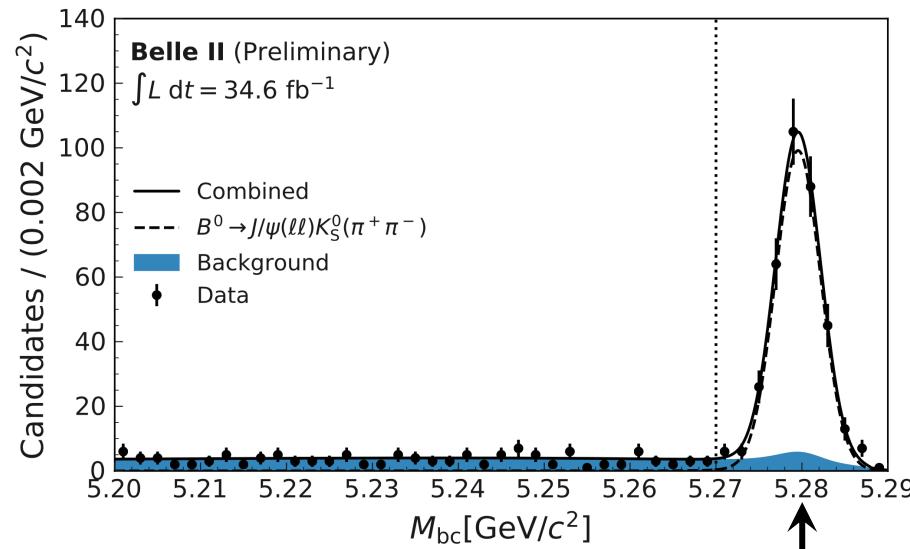


親粒子の再構成



- 「一般的に」崩壊前の親粒子の同定は4元運動量から再構成される質量分布を用いる
 - $m(B^0) = 5.280 \text{ GeV}/c^2$
 - $m(J/\psi) = 3.097 \text{ GeV}/c^2$
 - $m(K_S) = 0.498 \text{ GeV}/c^2$

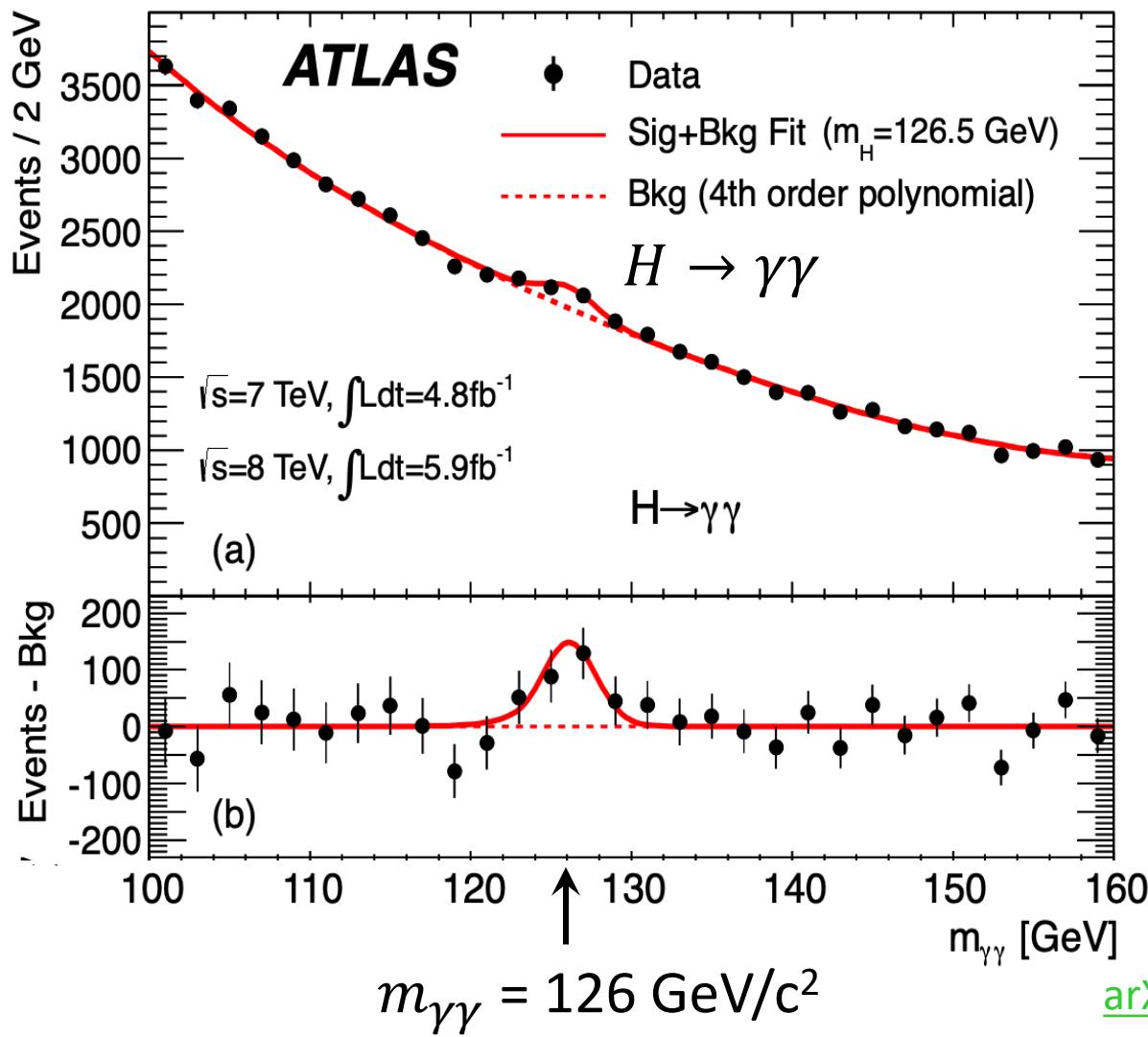
Step.3: B^0 中間子を再構成



$$m_{B^0} = 5.28 \text{ GeV}/c^2$$

Belle II実験 (e^+e^-) のデータ
大部分が $e^+e^- \rightarrow \gamma(4S) \rightarrow B\bar{B}$ の
非常にクリーンな実験

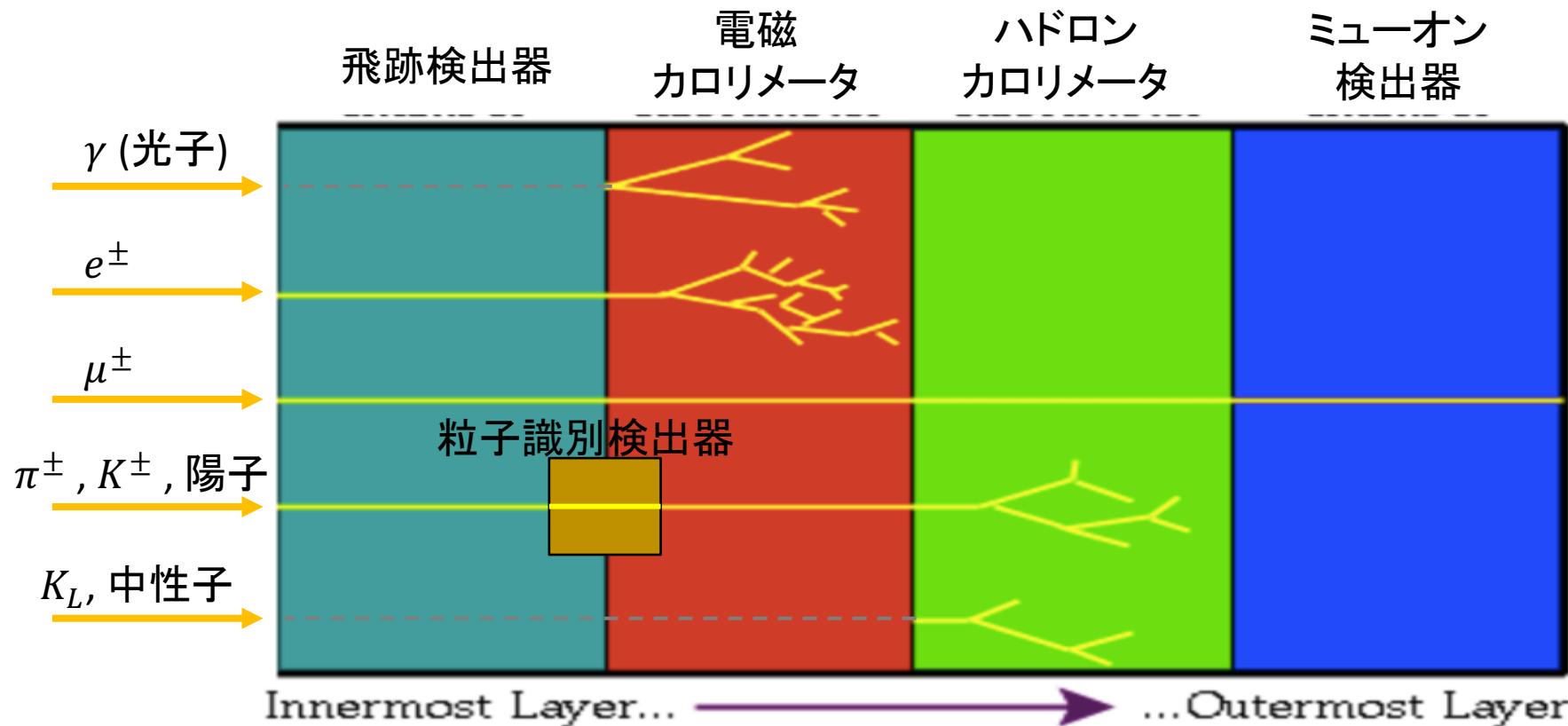
例：Higgs粒子発見 (ATLAS/CMS)



以上を踏まえて Belle II 実験の説明

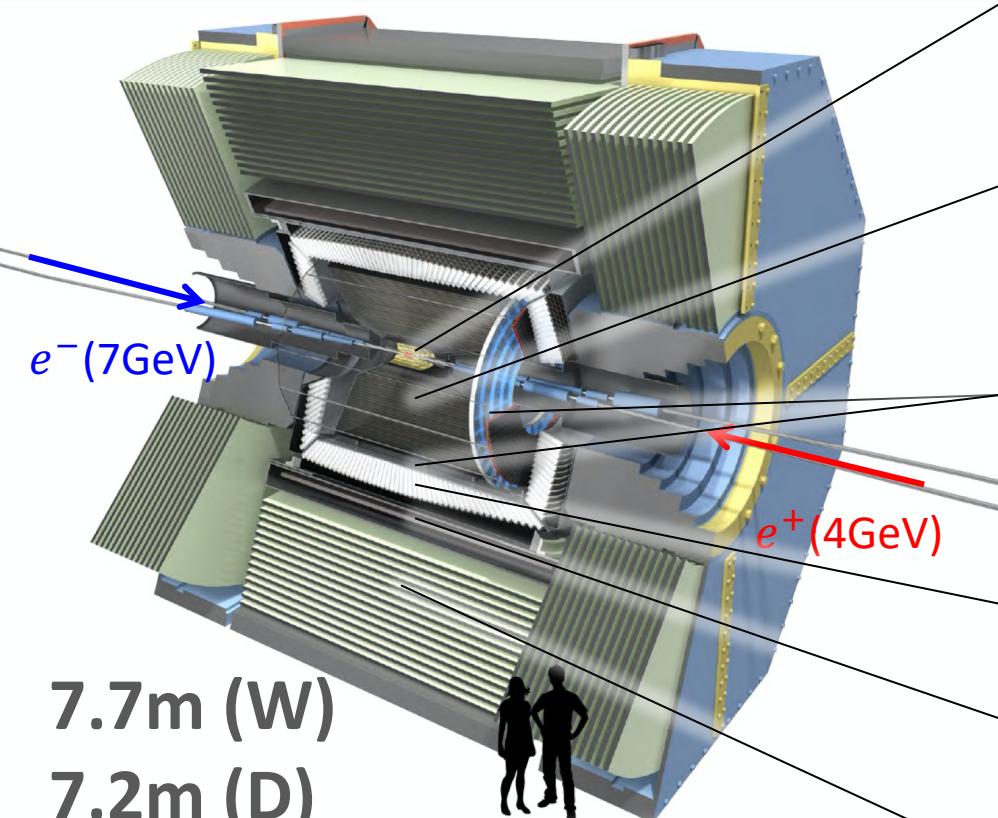
その前に質問などありませんか？

終状態の粒子測定のまとめ



ν (ニュートリノ) はほぼ反応しない

Belle II 測定器



7.7m (W)

7.2m (D)

7.9m (H)

物理測定領域: $17^\circ < \theta < 150^\circ$

Fast and broadband DAQ

- Maximum Level-1 rate: 30kHz
- Typical data size: 1MB/event

崩壊点検出器

- Inner 2 layers: DEPFET pixel sensor
- Outer 4 layer: DSSD (strip) sensor

ドリフトチェンバー (DC)

- Smaller cell size than Belle

PID検出器

- Barrel: Time-Of-Propagation counters
- Endcap: Aerogel RICH
- mis-PID ... half of Belle

EMカロリメータ

- CsI(Tl) + wave-form readout

超伝導電磁石ソレノイド: 磁場 1.5 T

K_L/μ -検出器

- Outer barrel: RPC (streamer)
- Endcap/inner barrel: Sci. + WL shift

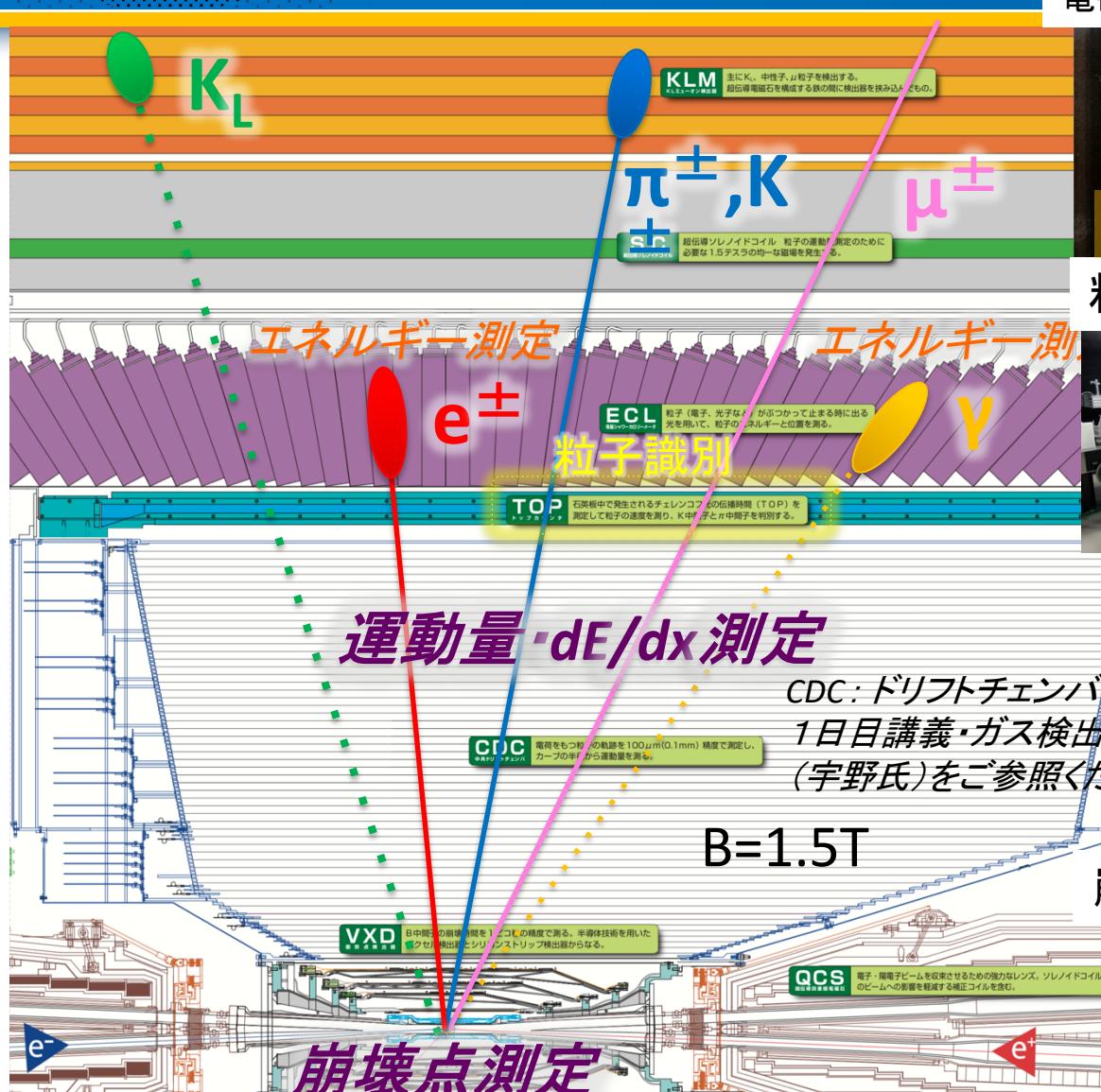
Level-1 トリガーシステム

- Tracking + EM-cal + μ
- L1 trigger latency : 5 μ sec

内層

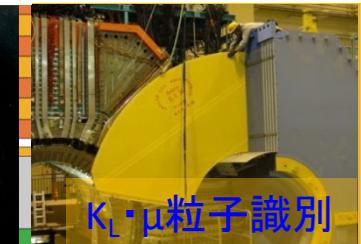
外層

Belle II 検出器による粒子測定



電磁カロリメータ(ECL) K_L・μ粒子検出器(KLM)

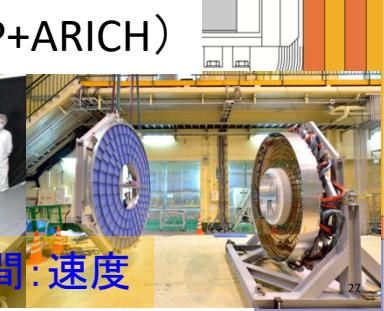
e/γエネルギー



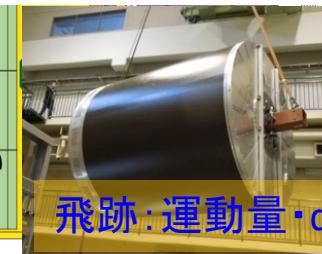
粒子識別(TOP+ARICH)



時間・速度



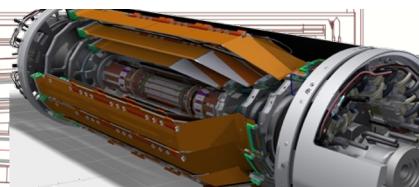
中央飛跡検出器(CDC)



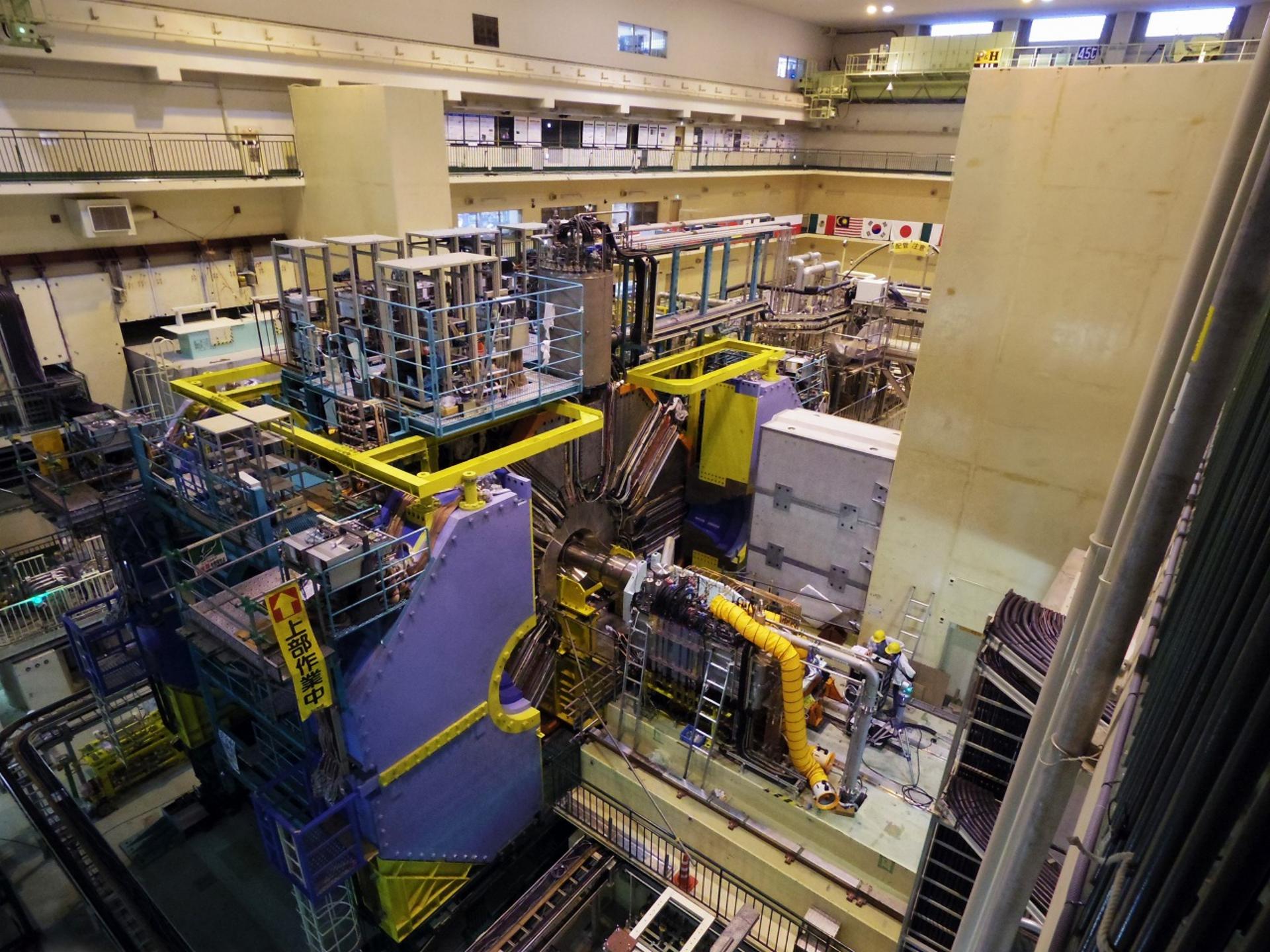
CDC: ドリフトチャンバー
1日目講義・ガス検出器
(宇野氏)をご参照ください

飛跡・運動量・dE/dx

崩壊点検出器(PXD+SVD)



崩壊位置・(運動量・dE/dx)

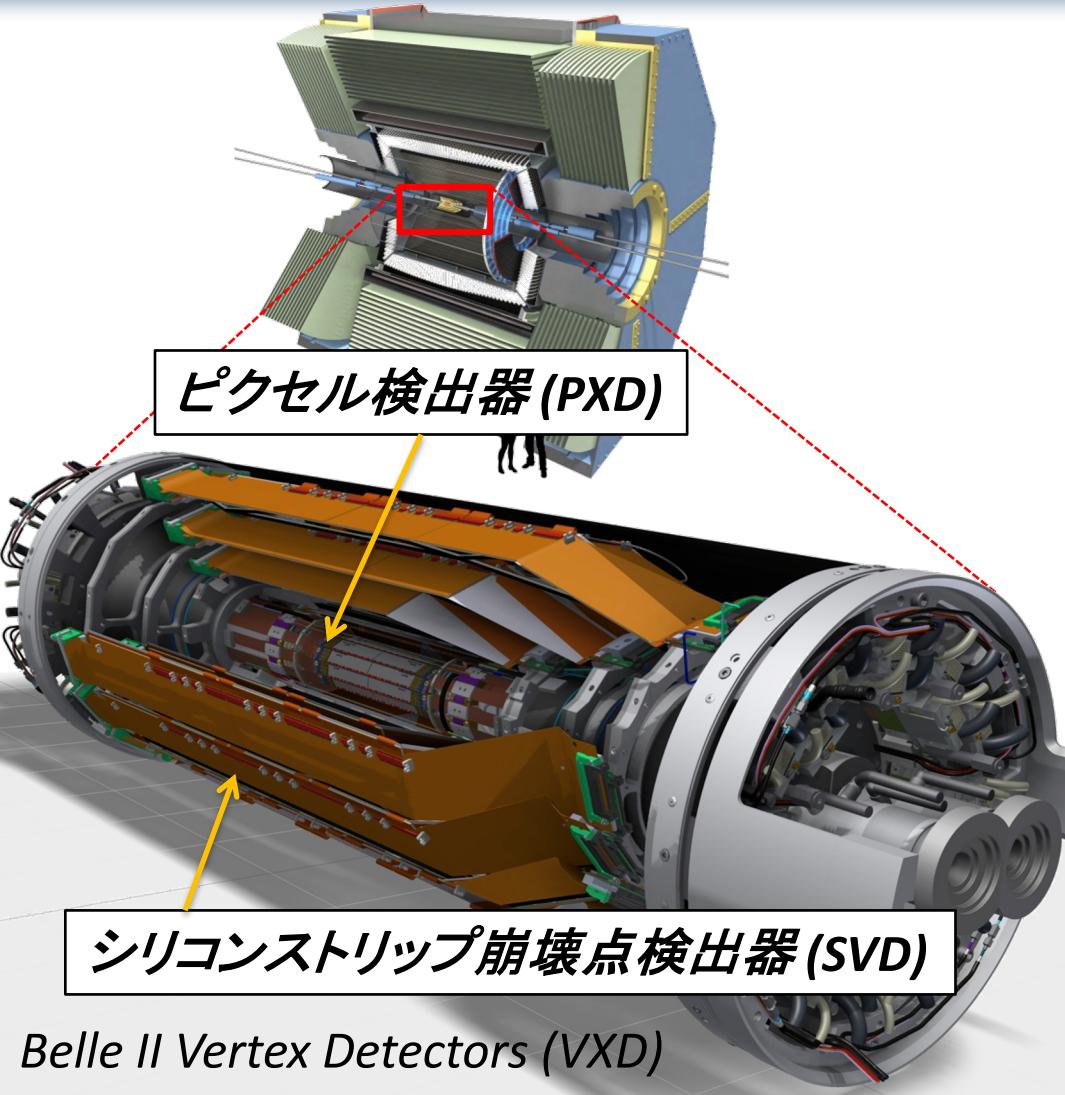


455

P H

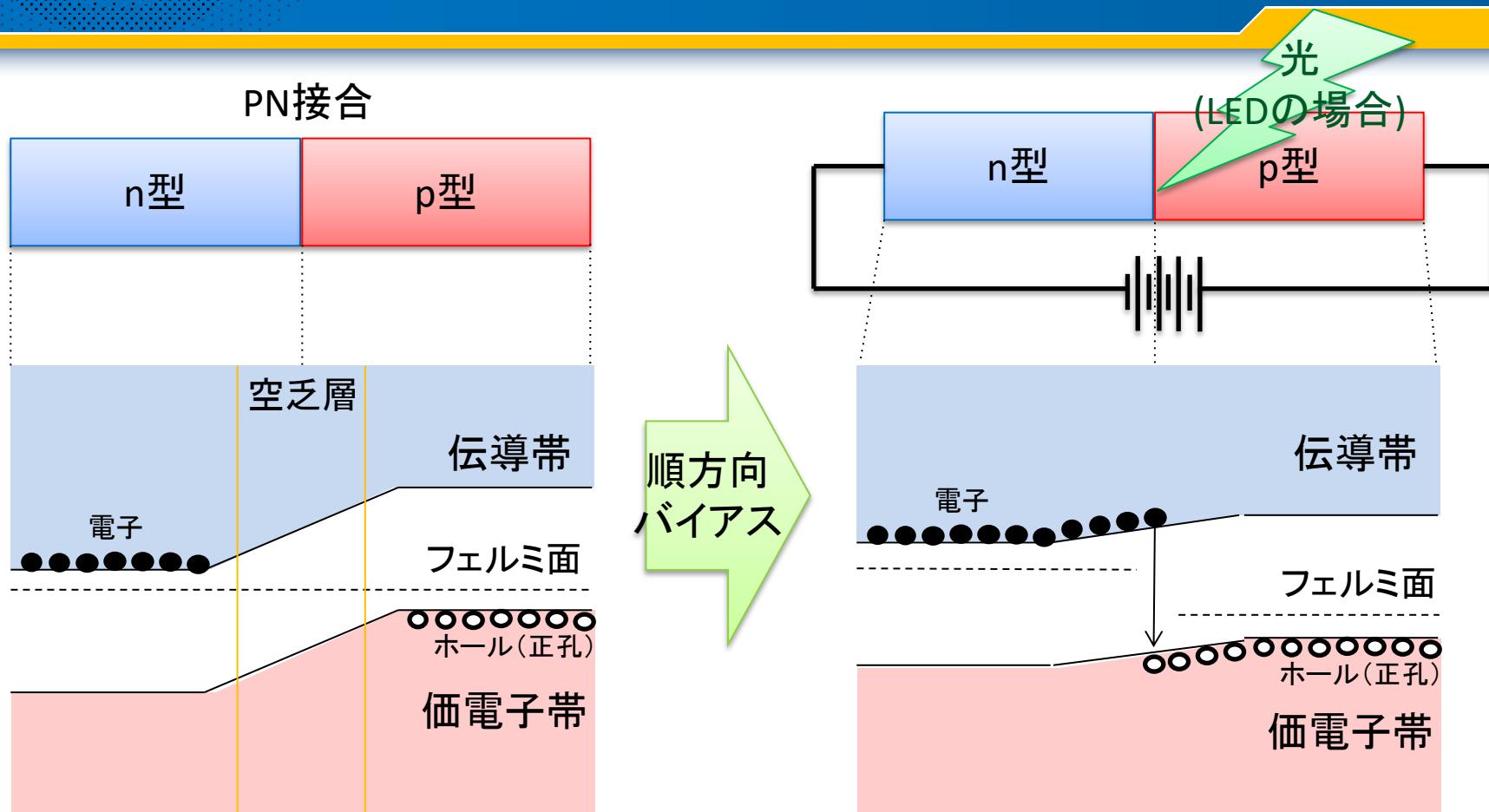
Belle IIの検出器 (一部のみ)

シリコン崩壊点検出器



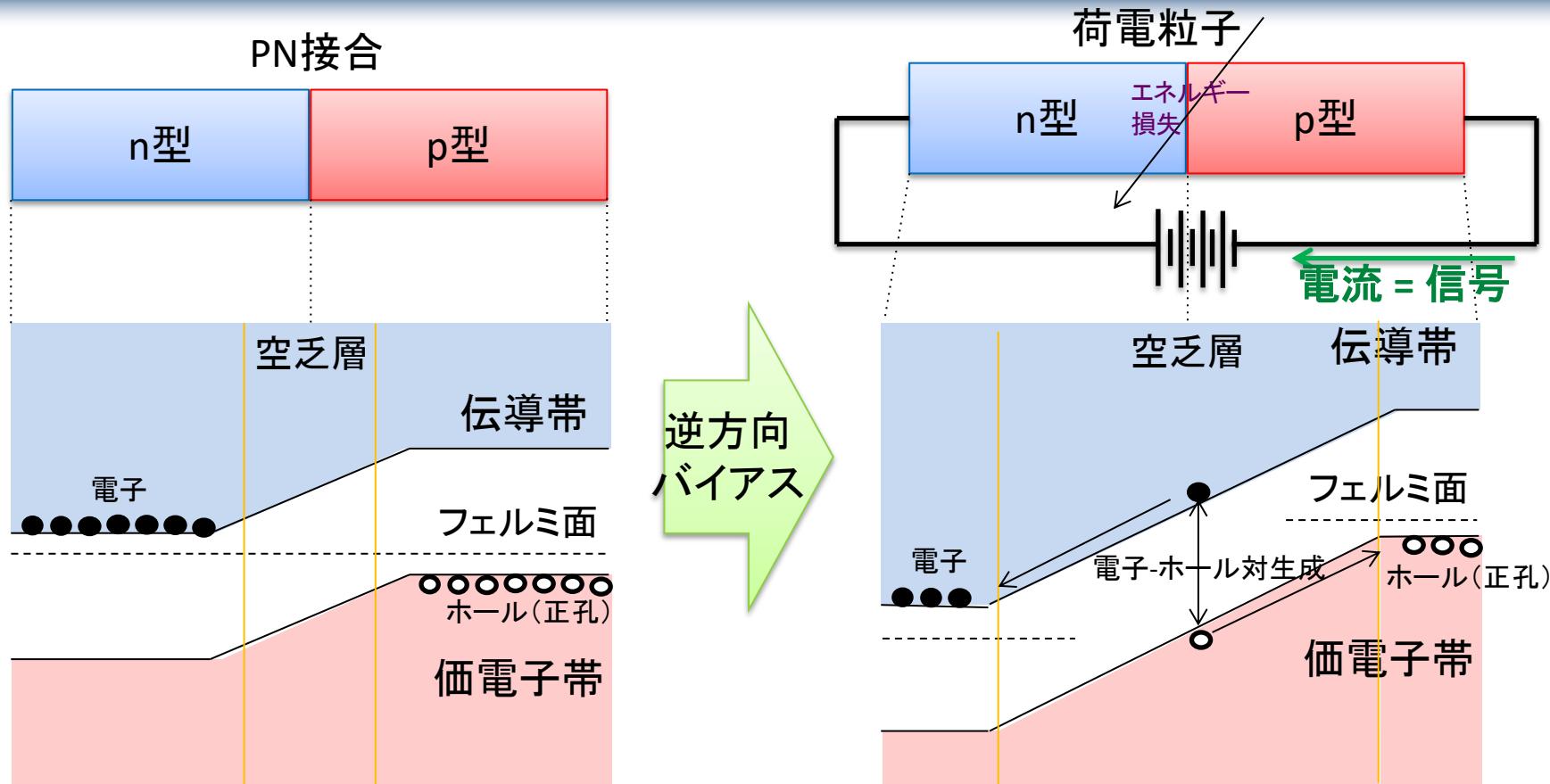
- Belle II検出器のビーム衝突点に設置
- 2つのシリコン検出器から構成
- **ピクセル検出器 (PXD)**
 - 内側2層
 - DEPFET センサー
- **シリコンストリップ崩壊点検出器 (SVD)**
 - 外側4層
 - Double-sided Si strip detectors (DSSDs)

シリコン検出器の原理



- PN接合に順方向に電圧をかけると電流が流れる。
 - → ダイオード(整流性), LED (Light Emitting Diode)

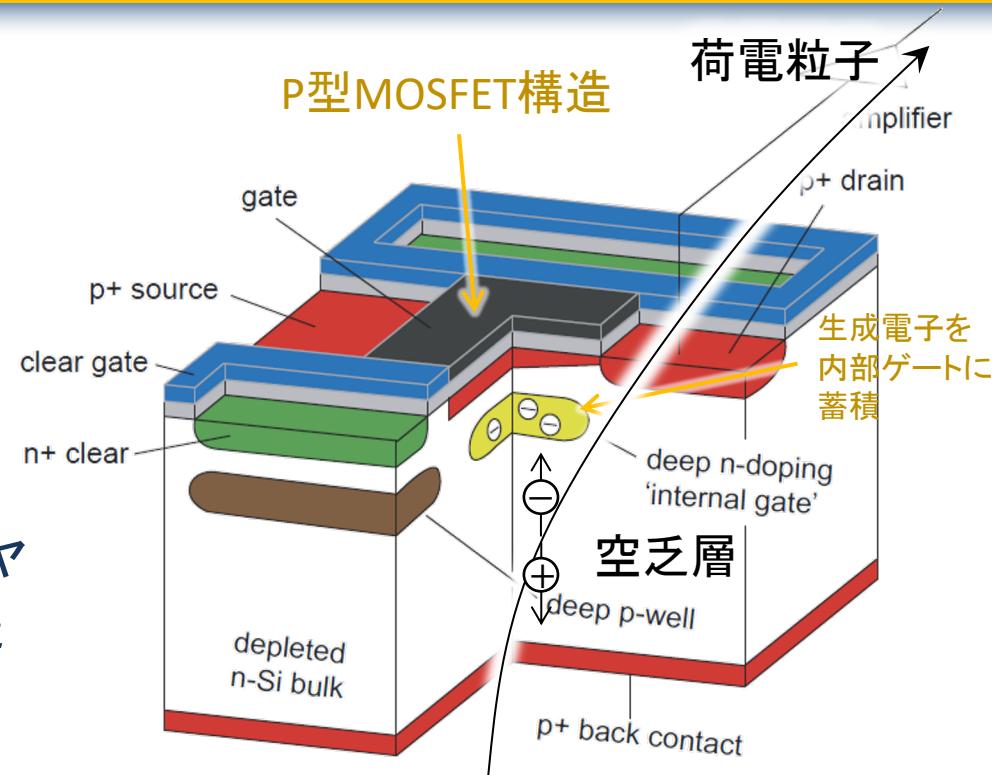
シリコン検出器の原理



- PN接合に逆方向に電圧をかけると空乏層が増大
- 空乏層に荷電粒子が通過すると、エネルギー損失分の電子-ホール対が生成され、電流変化として検出される
 - → シリコン検出器

ピクセル検出器：DEPFETセンサー

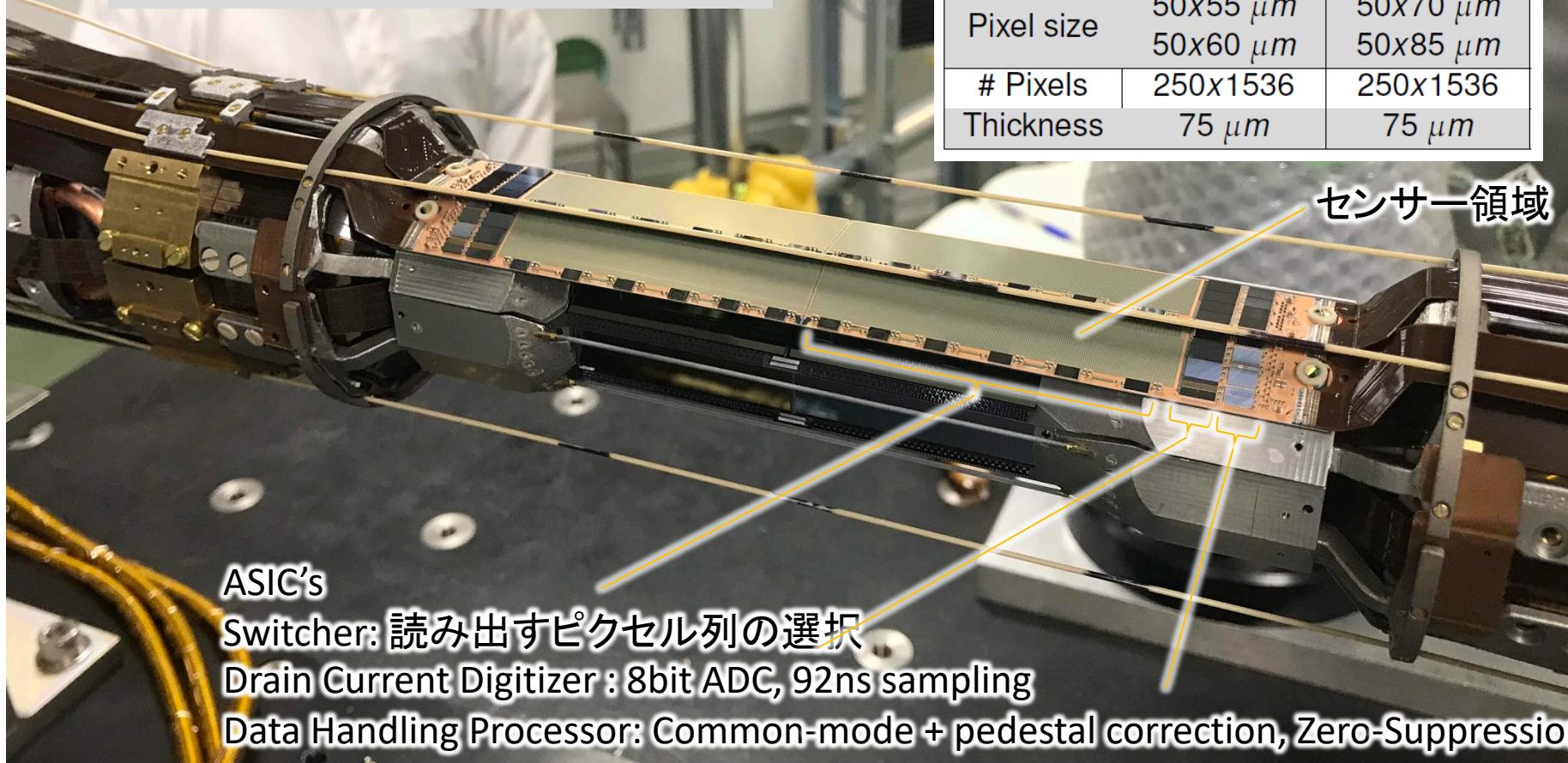
- Depleted P-channel Field Effect Transistor
 - 空乏化したP型MOSFET
- 荷電粒子により生成した電子が内部ゲートの電位を変化
 - n型ドープによるポテンシャル極小領域に電子を捕獲
- → ソース-ドレイン間の電流が変化
 - 増幅率 $\sim 400 \text{ pA}/e^-$
- 蓄積電荷は定期的にクリアされる



詳細は1日目講義・シリコン検出器
(岸下氏)をご参照ください

ピクセル検出器：DEPFETセンサー

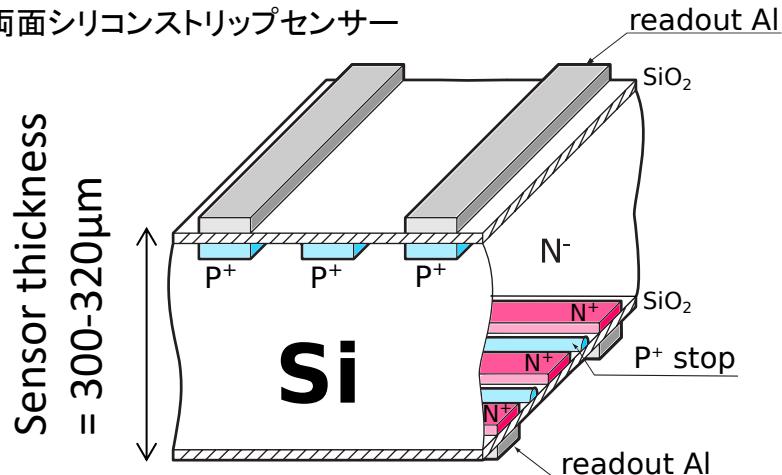
製作の遅れにより
第2層は2モジュールのみ設置
(2022年にFullの検出器と交換)



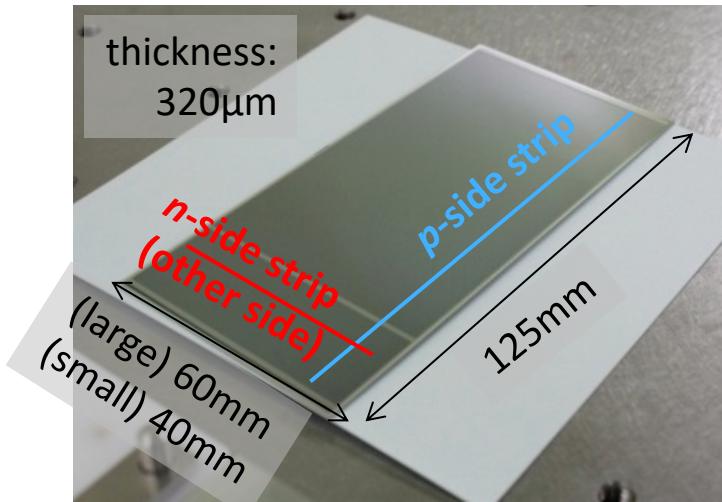
ストリップ検出器：DSSDセンサー

DSSD (Double-sided Si strip detector)

= 両面シリコンストリップセンサー



センサーの写真 (HPK 製)



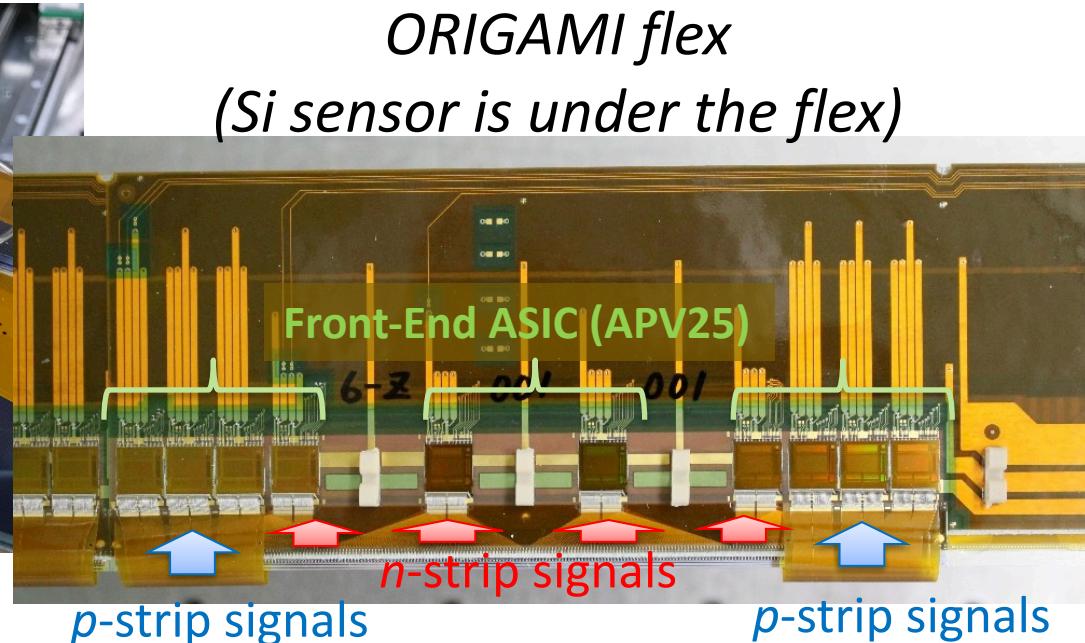
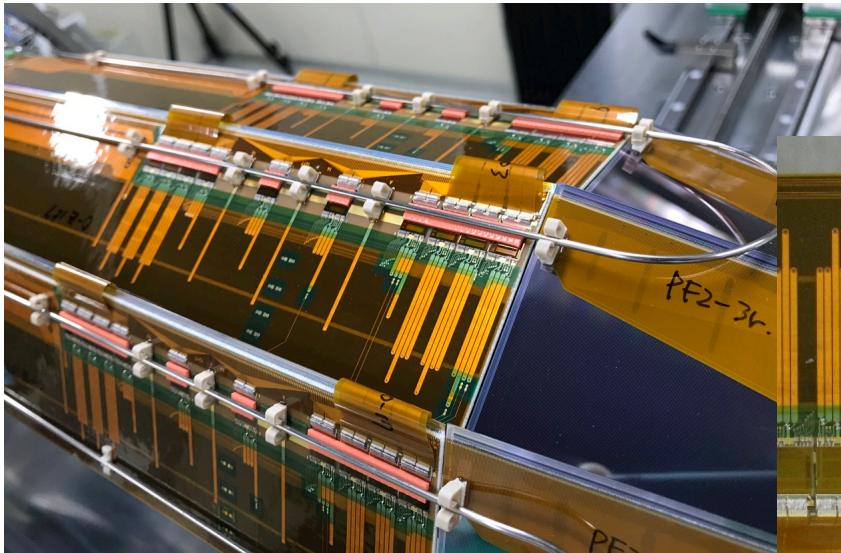
Strip numbers and pitches

読み出しストリップの仕様

p側ストリップ本数	768
p側ストリップ間隔	50 μm
n側ストリップ本数	768
n側ストリップ間隔	160 μm

小さい長方形センサー

Chip-On-Sensor Concept



- シリコンからの信号は小さい
- 加速器の高いバックグラウンドレートに耐えるためには、読み出し時定数を短く(50nsec)する必要がある
- → ノイズを小さくすることが課題となる

読み出しASICをセンサーの直上に配置することで検出器容量を削減し、ノイズを最小化: **Chip-On-Sensor concept**

ASICは100um厚まで削る

シリコン崩壊点検出器

ピクセル検出器に
ストリップ検出器の半分が
取り付けられた写真

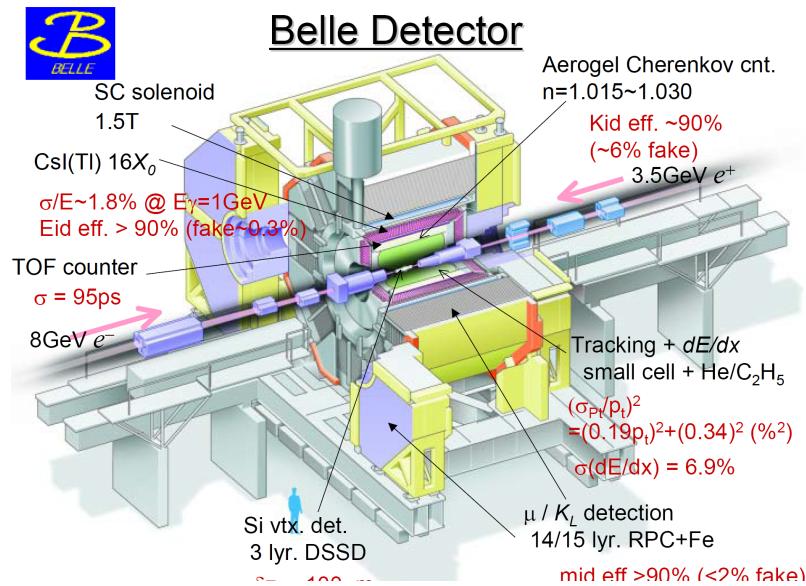


崩壊点検出器をBelle IIに
設置している写真



TOP(Time-Of-Propagation)検出器

- TOF(Time-Of-Flight)による粒子識別はエネルギーが高い実験になるほど困難になる
 - 粒子種による速度差は小さくなる
 - 識別精度向上にはとても大きな検出器が求められる
 - $\delta\beta = \beta^2/L \times \delta t$

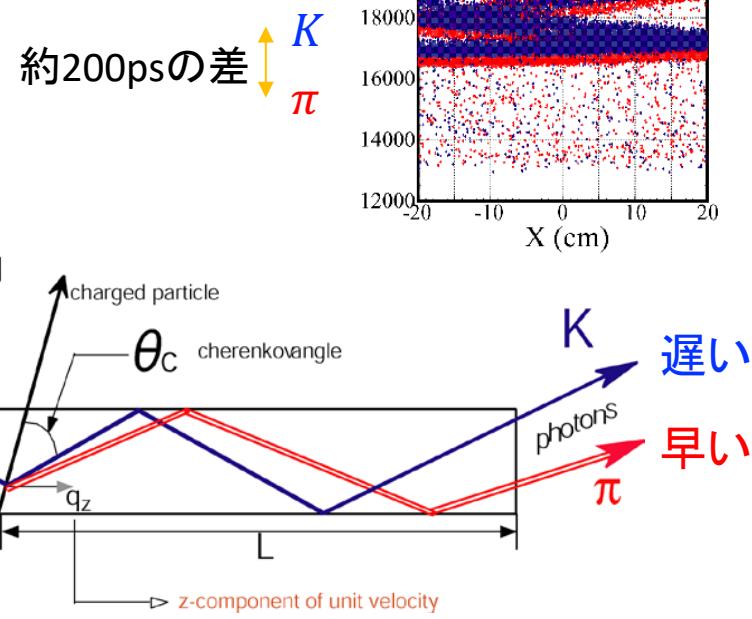
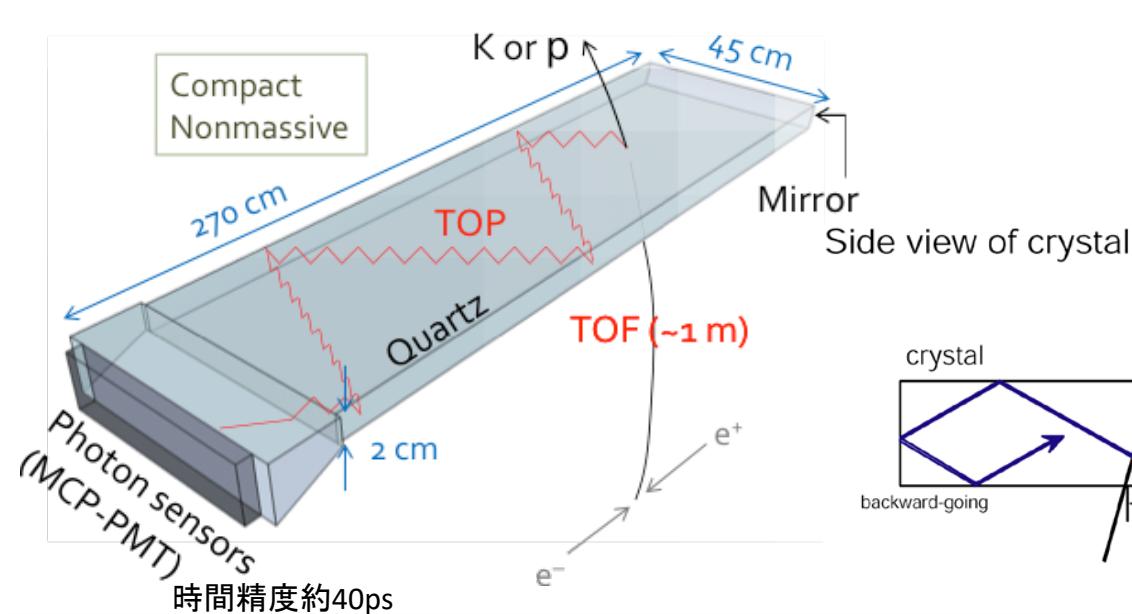


先代のBelle実験では
TOF検出器と
閾値型チェレンコフ検出器の
2つの粒子識別検出器が
必要となっていた。

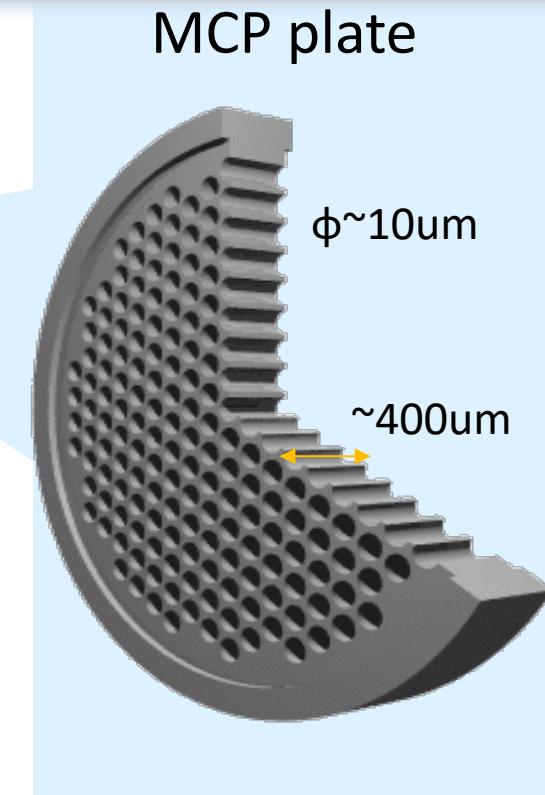
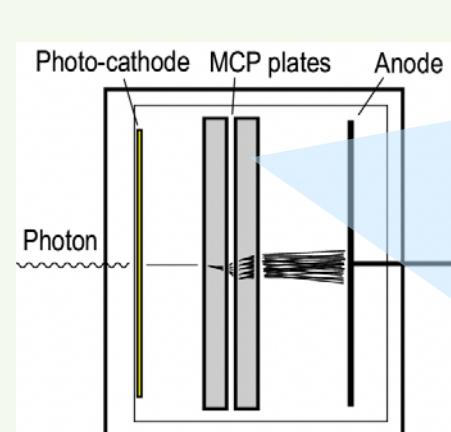
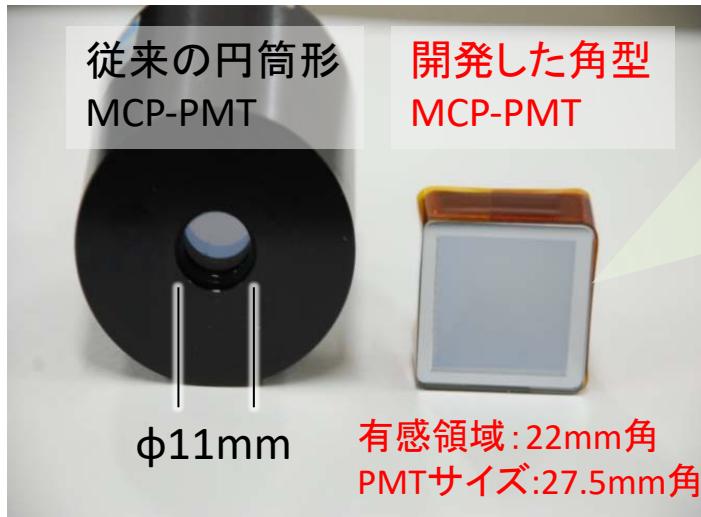
1つにできないか？

TOP(Time-Of-Propagation)検出器

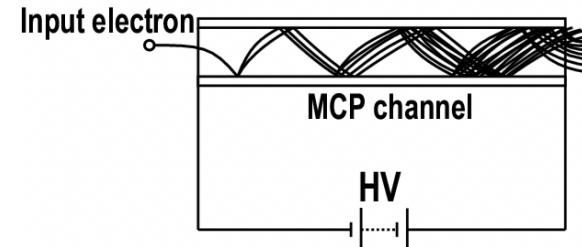
- TOP(Time-Of-Propagation): チェレンコフ光の到達時間と発生位置を測定
- 石英内のチェレンコフ光の角度 θ_C の違いにより到達時間が変化
 - TOF+TOP測定: 検出器サイズを変えること無く、粒子識別の精度を向上するアイデア



TOP(Time-Of-Propagation)検出器

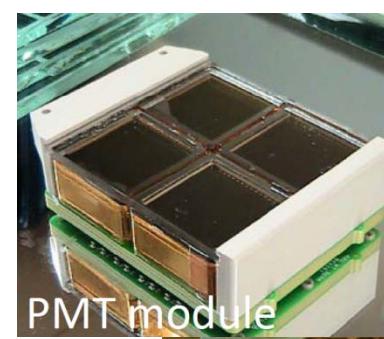
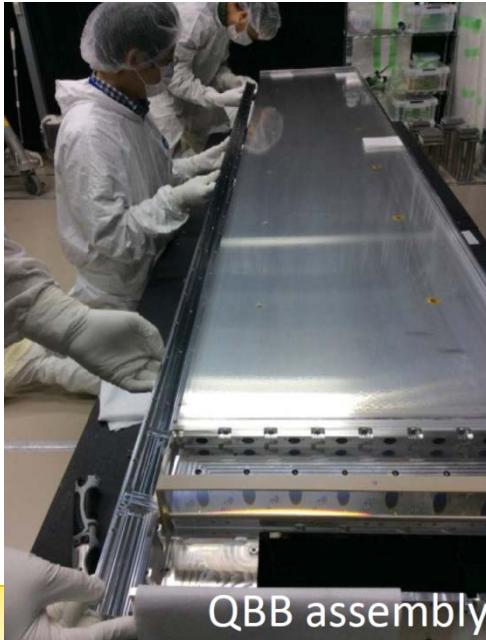
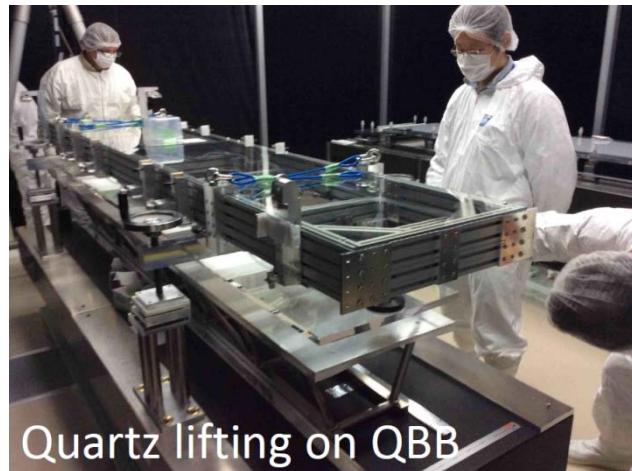
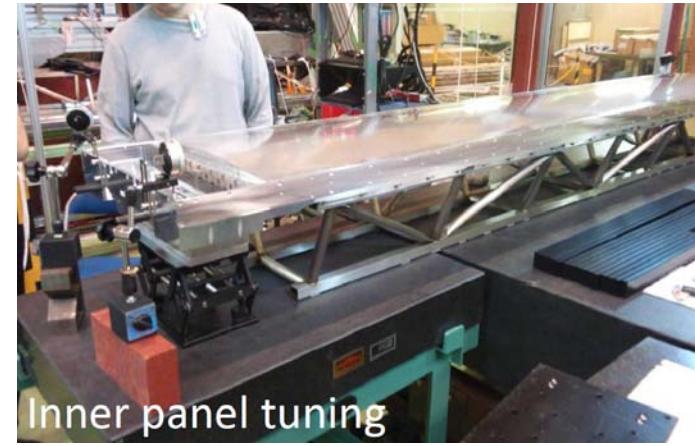
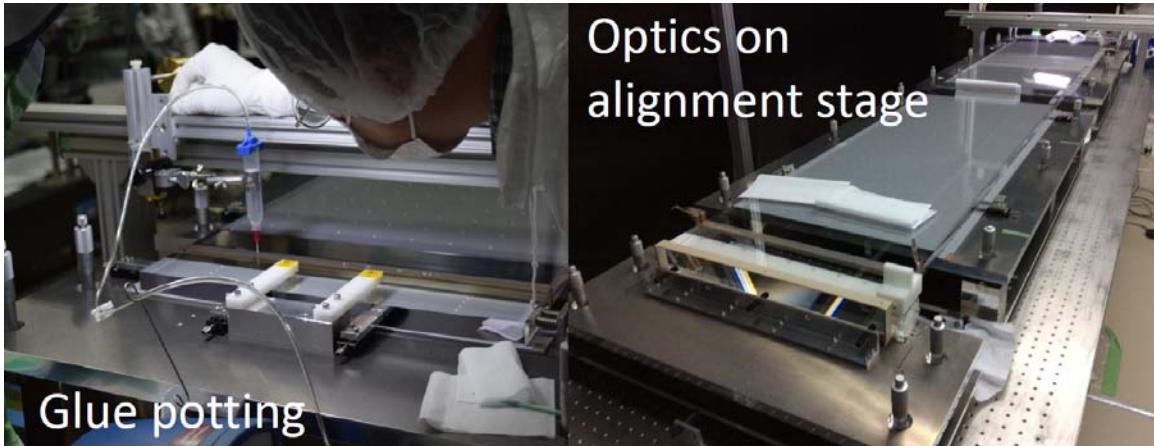


- チェレンコフ光検出 : MCP-PMT
(Micro-Channel-Plate PMT)
- 狹い領域で高い電子増幅率を実現
→ 高い時間分解能 : 40ps以下

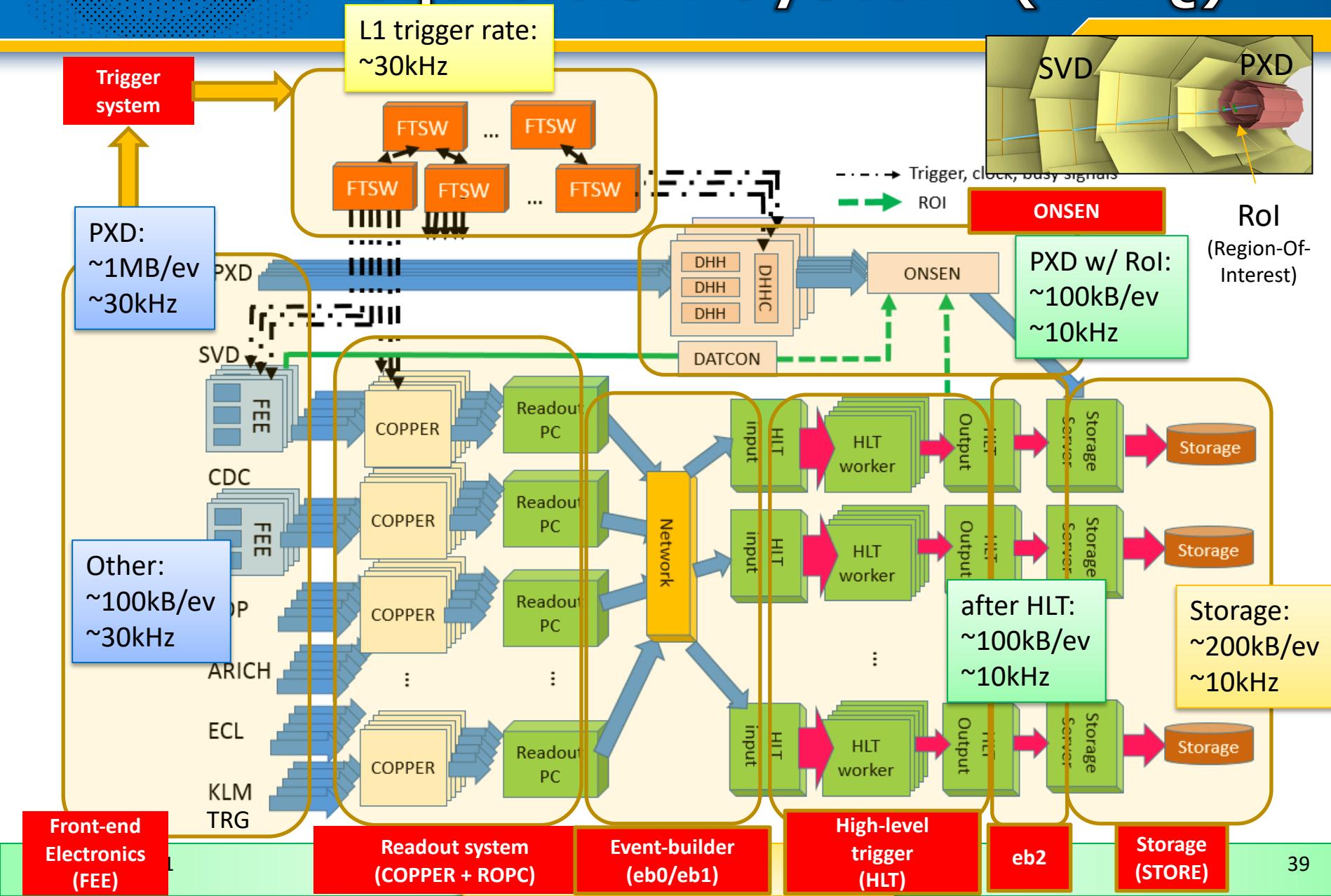


TOP(Time-Of-Propagation)検出器

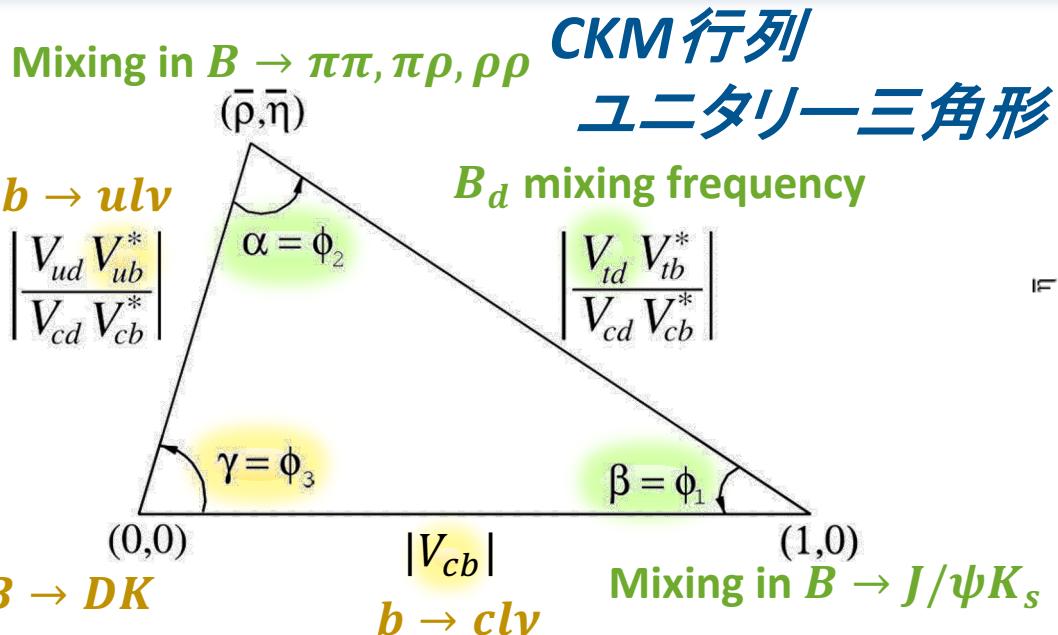
- 製作手順の開発、(16+1)台の製作



Data Acquisition System (DAQ)



代表的なBelle IIでの物理: CKM精密検証



Belle II実験だけで3辺・3角のすべてを測定可能

Tree と Loop とでユニタリ-三角形が一致するか?

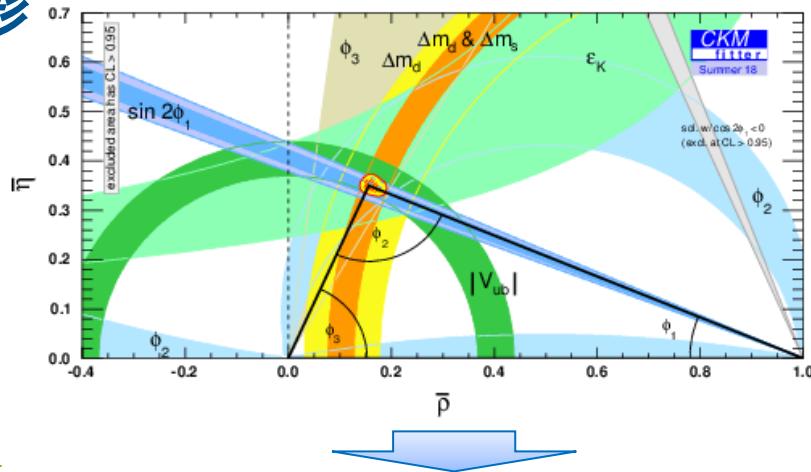
目標ルミノシティー 50 ab^{-1} での予想感度

- 全ての角を ~ 1 度の誤差で測定
- 全ての辺を $1 \sim 2\%$ の誤差で測定

新物理のエネルギー-スケールにして 200 TeV もの
感度を有する

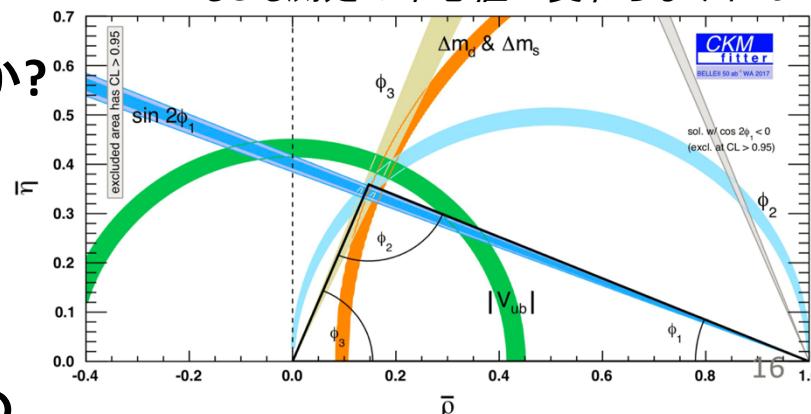
arXiv:1309.2293

Before Belle II (2018)



After Belle II (50/ab)

もしも測定の中心値が変わらなければ...



崩壊点測定と時間依存CP非対称度測定の繋がり

崩壊幅の時間依存CP非対称度

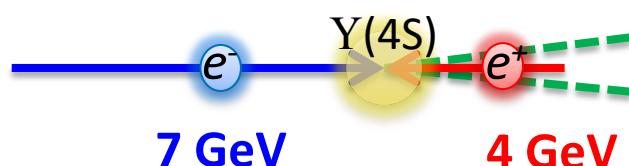
$$\Gamma_{B^0 \rightarrow f_{CP}}(\Delta t) \propto \exp\left[-\frac{|\Delta t|}{\tau_{B^0}}\right] \times (1 - A \cos \Delta m_d \Delta t - S \sin \Delta m_d \Delta t)$$

$$\Gamma_{\bar{B}^0 \rightarrow f_{CP}}(\Delta t) \propto \exp\left[-\frac{|\Delta t|}{\tau_{B^0}}\right] \times (1 + A \cos \Delta m_d \Delta t + S \sin \Delta m_d \Delta t)$$

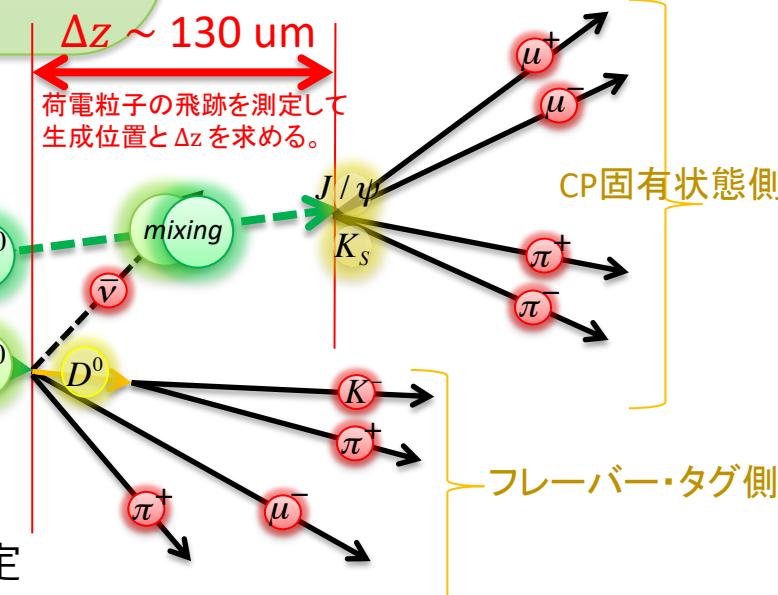
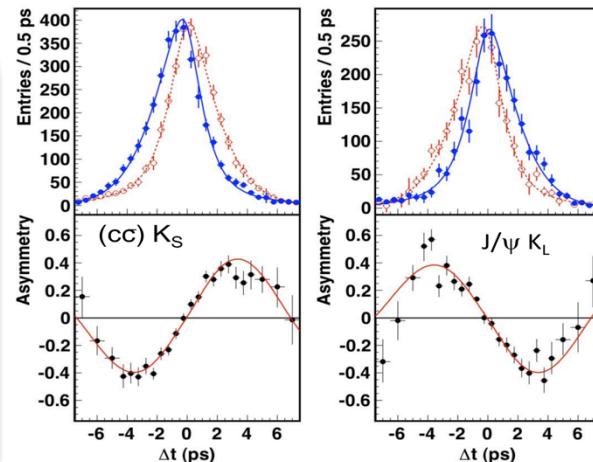
e.g. $S(B \rightarrow J/\psi K_s) = \sin 2\varphi_1$: CKM三角形の角度

Δt : 2つのB中間子対の崩壊時刻の差

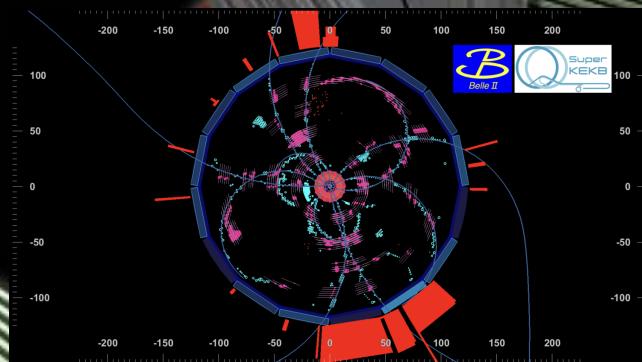
B^0 中間子の平均崩壊時間(寿命 τ)= 1.5 ピコ秒
 $\rightarrow \Delta z = \Delta t \times c\beta\gamma = 130 \mu\text{m}$



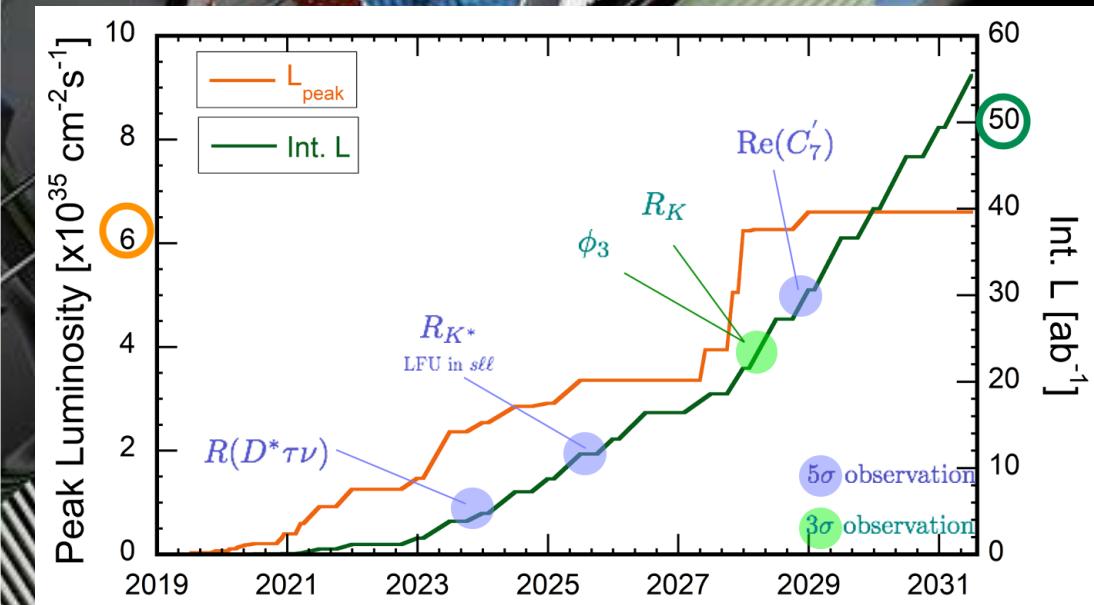
量子もつれ (EPR相関) により
タグ側とは反対のBのフレーバーが決定



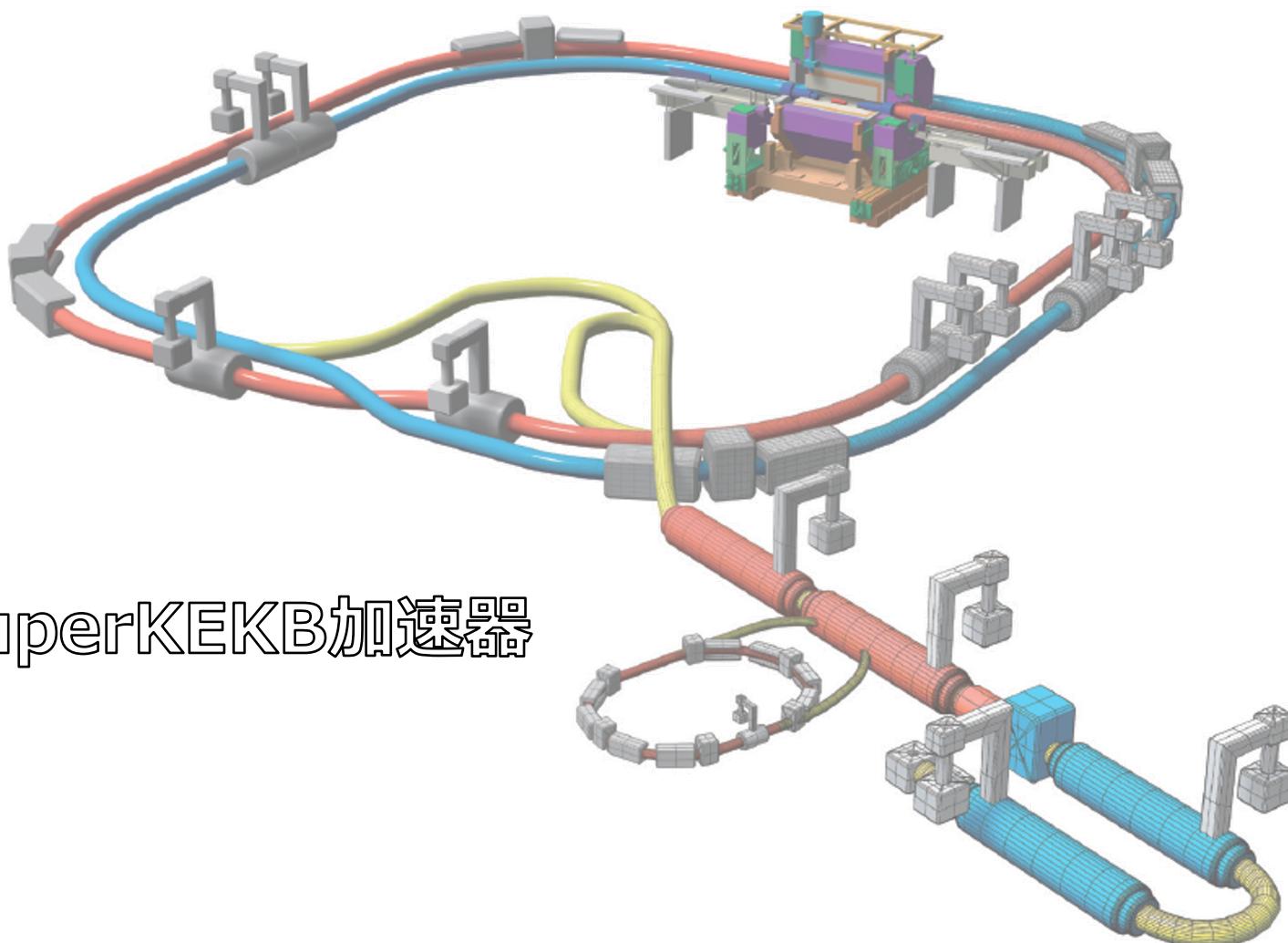
最後に



- 今回はBelle II実験での粒子計測をメインに説明しましたが、検出技術は実験ごとに大きく異なり、また技術開発は日進月歩で進み新しい検出器が様々あります。
- Belle II実験以外でつかわれている検出器技術も是非調べてみてください。

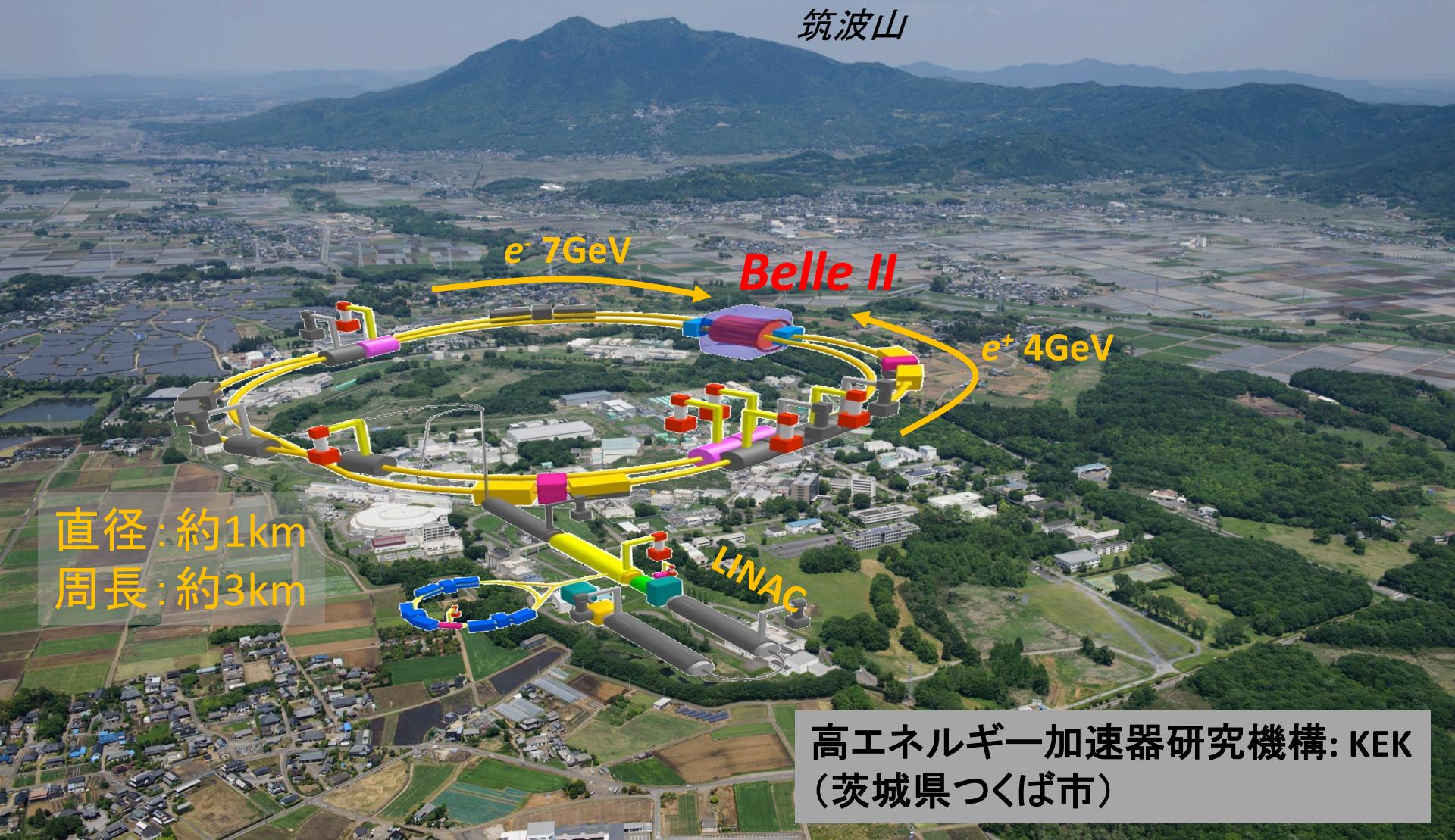


Backup



SuperKEKB 加速器

SuperKEKB加速器 @ KEK

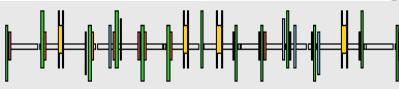


SuperKEKB加速器

**KEKB 加速器から
SuperKEKB 加速器へ**

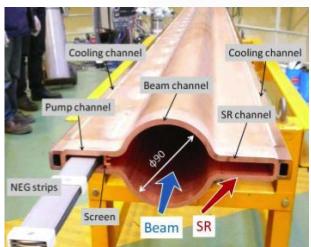


短い偏極電磁石を
長いものに交換



低エミッタンス化のため
光学系の再設計

アンテチエンバー付きビームパイプ
(TiNコーティング)



電子雲の削減
低エミッタンス化
低SRパワー密度

Belle II 検出器

最終収束超伝導電磁石(QCS)



衝突点でのビームサイズを
約60nmにまで絞る

SuperKEKB Main Ring

$e^- 7\text{GeV} 2.6 \text{ A}$

周長: 約3km,
RF周波数: 509MHz

目標輝度: $8 \times 10^{35} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$

陽電子源
ターゲット
の改造

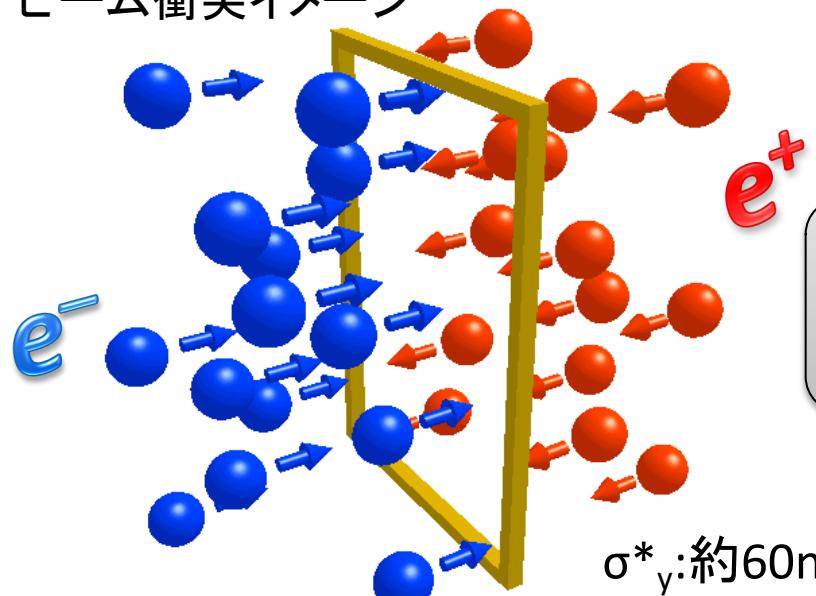


ダンピングリング
(陽電子@1.1GeV)
入射陽電子ビームの
低エミッタンス化

低エミッタンス電子銃
入射ビームの
低エミッタンス化

加速器とルミノシティー（輝度）

ビーム衝突イメージ



物理事象の
生成頻度
 $[s^{-1}]$

$$Y = \sigma \times L$$

反応断面積
自然法則で決定
人間は変えられない
 $[cm^2]$

ルミノシティ
加速器の性能
人間の努力で向上
 $[cm^{-2}s^{-1}]$

ルミノシティーの増強(目標40倍)

- ビーム電流を上げる

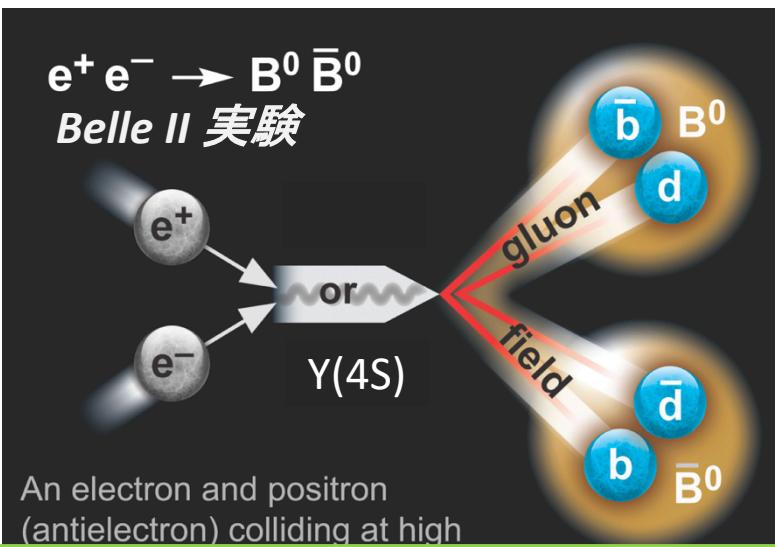
- KEKBから2倍に増強

- ビームサイズを小さくする

- 垂直ベータ関数を小さくする

- ビームの低エミッタンス化

- KEKBから20分の1に改善



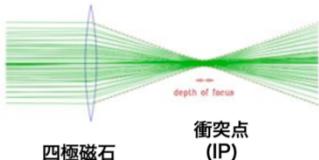
反応断面積:

$$\sigma(E_{cm} \sim 11\text{GeV}) = 1.1\text{nb} = 1.1 \times 10^{-33}\text{cm}^2$$

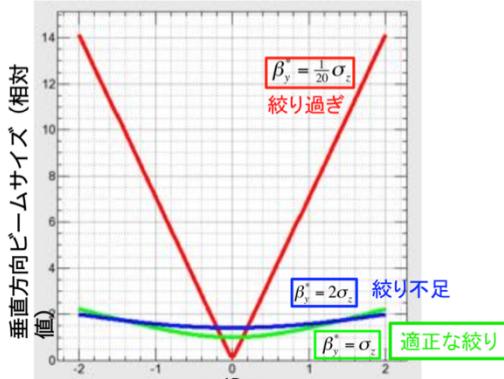
極細のビームサイズへの挑戦

世界初の「ナノビーム方式」衝突

「砂時計効果」による制限



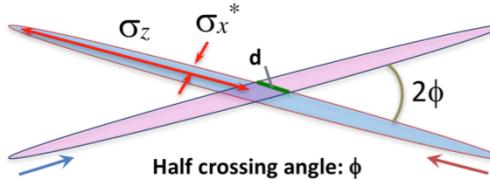
しかし、衝突点で絞り過ぎると、衝突点の両側でふくれる（砂時計のように）。



正面衝突、有限角度衝突、クラブ衝突、いずれの場合も、ビームの重なる長さ程度まですか、絞れない。

新しい、「ナノ・ビーム」方式

Nano-Beam Scheme



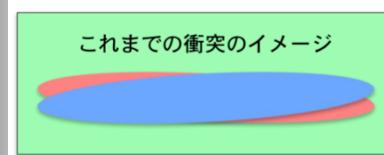
P. Raimondi が発案。
SuperKEKBで採用。

$$\beta_y^* \geq \frac{\sigma_x^*}{\phi} = d$$

~200-300 μm

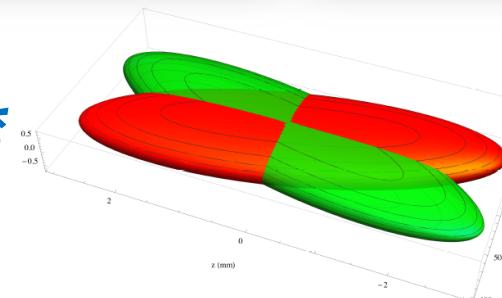
長く、細く、極めて薄いパンチ同士（進行方向 6 mm、水平方向 10 μm、垂直方向 50~60 nm）を大きな交差角（約5度）で衝突させる。

これまでの衝突のイメージ

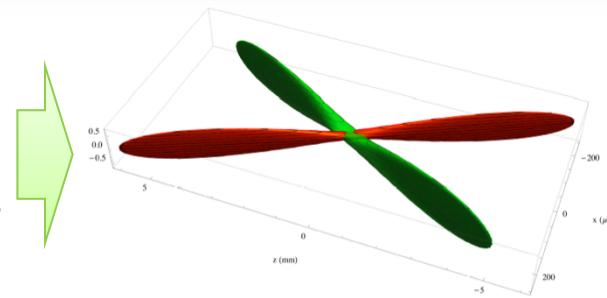


ビームの重なり部分が短いので、ビームを非常に細くしぼれる。（重なっていない部分は、砂時計効果でふくれても構わない。）

ナノビーム方式により、
ビームサイズを極限まで
絞ることが可能になる。



従来の衝突イメージ



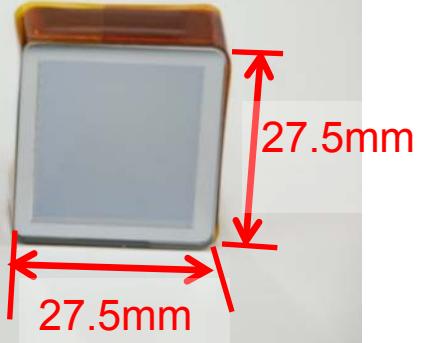
ナノビームでの衝突イメージ

光検出器(MCP-PMT)

従来型 円筒形
MCP-PMT

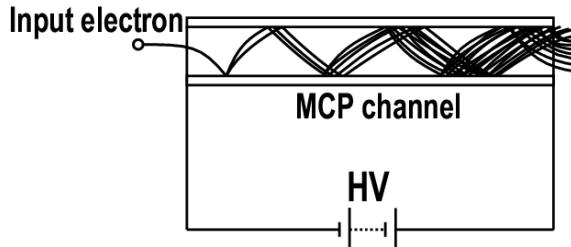


角型
MCP-PMT

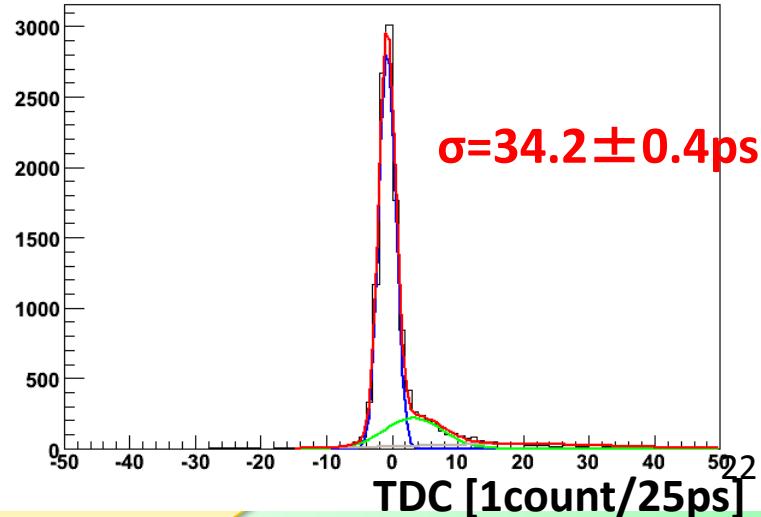
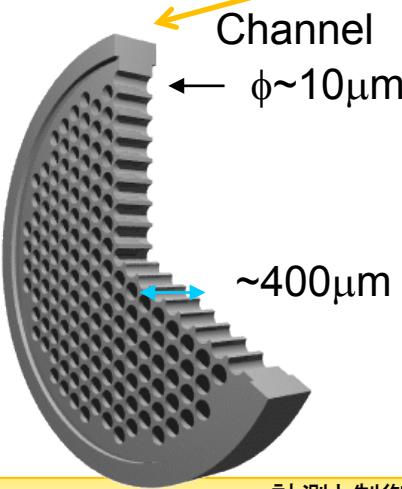
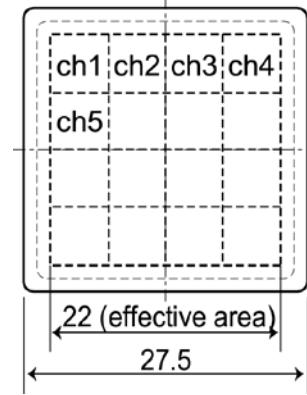
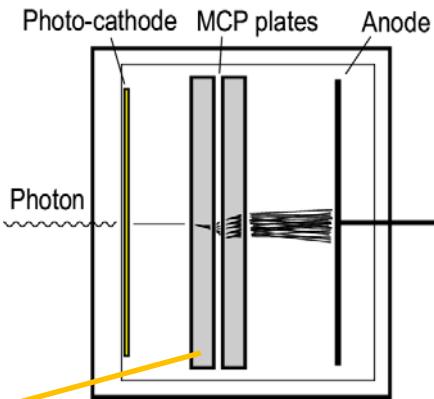


浜松ホトニクス社と共同開発

電子増倍部にMCPを使用
狭い領域で高い增幅率を達成する
ことで高時間分解能を実現



- 1.5T磁場中で1光子検出可能(gain>10⁶)
- 高時間分解能 $\sigma < 40\text{ps}$
- 角型で高有効面積率 64%
- 位置情報 4x4 読み出し (5mmピッチ)



試作器製作・試験

- 石英輻射体(岡本光学加工所, Zygo社)
 - 高精度研磨大型石英板
 - $\sim 1\text{m} \times 40\text{cm} \times 2\text{ cm}$
 - 平面性: $<1.2\mu\text{m}/\text{m}$, 面粗度: $<0.5\text{nm}$
 - フォーカスミラー ($R=5\text{m}$)
 - 平面度 0.2mrad で接着
- アルミニハニカム支持体
 - 昭和飛行機社
- 複数回に亘るビームテスト

